股票代碼：　3228

RDC®

金麗科技股份有限公司

RDC Semiconductor Co., Ltd.

113 年 度

年　　報

中華民國 114 年 5 月 13 日刊印

查詢年報網址：https://mops.twse.com.tw

一、發言人及代理發言人姓名、職稱、聯絡電話及電子郵件信箱：

發言人姓名：呂世民

發言人職稱：財務處處長

聯絡電話：03-6662866

電子郵件信箱：spokesman@rdc.com.tw

代理發言人姓名：蘇迎曦

代理發言人職稱：財務處經理

聯絡電話：03-6662866

電子郵件信箱：spokesman@rdc.com.tw

二、總公司之地址及電話：

總公司地址：新竹科學園區新竹市力行路 2-1 號 6 樓之 1

電　　話　：03-6662866

三、股票過戶機構之名稱、地址、電話及網址：

名　稱：永豐金證券股份有限公司股務代理部

地　址：台北市博愛路 17 號 3 樓

電　話：(02)2381-6288

網　址：https://www.sinotrade.com.tw

四、最近年度財務報告簽證會計師姓名、事務所名稱、地址、電話及網址：

會計師姓名：劉倩瑜、謝智政

事務所名稱：資誠聯合會計師事務所

地　　址：台北市基隆路一段 333 號 27 樓

電　　話：02-2729-6666

網　　址：https://www.pwc.tw

五、海外有價證券掛牌買賣之交易所名稱及查詢該海外有價證券資訊之方式：無。

六、公司網址：https://www.rdc.com.tw

目　　錄

壹、致股東報告書 1
貳、公司治理報告 2
一、董事、監察人、總經理、副總經理、協理、各部門及分支機構主管資料 2
二、公司治理運作情形 11
三、簽證會計師公費資訊 35
四、更換會計師資訊 35
五、公司之董事長、總經理、負責財務或會計事務之經理人，最近一年內曾任職於簽證會計師所屬事務所或其關係企業者 35
六、最近年度及截至年報刊印日止董事、監察人、經理人及持股比例超過百分之十之股東股權移轉及股權質押變動情形 36
七、持股比例占前十名之股東，其相互間為關係人或為配偶、二親等以內之親屬關係之資訊 37
八、公司、公司之董事、監察人、經理人及公司直接或間接控制之事業對同一轉投資事業之持股數，並合併計算綜合持股比例 37
參、募資情形 38
一、資本及股份 38
二、公司債辦理情形 41
三、特別股辦理情形 41
四、海外存託憑證之辦理情形 41
五、員工認股權憑證辦理情形 41
六、限制員工權利新股辦理情形 41
七、併購或受讓他公司股份發行新股辦理情形 41
八、資金運用計劃執行情形 41
肆、營運概況 42
一、業務內容 42
二、市場及產銷概況 51
三、最近二年度及截至年報刊印日止從業員工資料 62
四、環保支出資訊 62
五、勞資關係 63
六、資通安全管理 64
七、智慧財產管理計畫 66
八、重要契約 67
伍、財務狀況及財務績效之檢討分析與風險事項 68
一、財務狀況 68
二、財務績效 69
三、現金流量 70
四、最近年度重大資本支出對財務業務之影響 70

五、最近年度轉投資政策、其獲利或虧損之主要原因、改善計畫及未來一年投資計畫 70
六、風險事項分析及評估 71
七、其他重要事項 75
陸、特別記載事項 76
一、關係企業相關資料 76
二、最近年度及截至年報刊印日止，私募有價證券辦理情形 76
三、其他必要補充說明事項 76
柒、最近年度及截至年報刊印日止，如發生證交法第三十六條第二項第二款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項 76

壹、 致股東報告書

各位股東女士、先生：

感謝股東對公司的信賴與支持，回顧 113 年除繼續去化庫存的循環，AI 晶片需求持續旺盛，是半導體強勁反彈之年，WSTS 估計大幅增長約 19%，114 年仍將全面成長約 11%，隨著 AI 從建立 LLM 訓練大模型到推理應用的不斷演進，加上 Deepseek 演算法的改變，未來將因成本的下降，加速各項 AI 應用產品的產生，其中汽車自動駕駛及人形機器人將是很重要的應用產品，而 AI 晶片大部分的應用都架構在 x86CPU 的生態系下發展，金麗過去 20 幾年來利用在嵌入式市場的長期耕耘，驗證了開發 x86 最困難的相容性問題，113 年持續往 64 位元開發，讓客戶在效能、成本及產品彈性上有更多的選擇。秉持信守長期供貨承諾；對工業電腦及嵌入式市場客戶，除進行中的開發案將流片外，公司亦積極開發新客戶，前景可期；自動化市場在 113 年度隨著客戶應用端更加穩定，營收依舊往上成長，將會是未來公司相當穩固的基本盤營收；於高效能運算(HPC)市場上，基於公司持續研發的成果，公司除了在高階製程能提供單晶片解決方案外，亦可在成熟製程上搭配公司自主研發的動態電路技術及先進封裝，提供客戶多樣選擇及靈活應用於高效能運算上，客戶詢問及接受程度高。

113 年在下面幾個開發目標機會下持續與客戶洽談開發(ASIC)合約，(1).64 位元 4/8 核心＆(2).64 位元 16 核心：工業/自動化 IPC 應用/PC，NB、(3).64 位元 32/64 核心：edge server/AI server、(4).64 位元 128 核心：data center、(5).PCIe Switch、(6).5G 基地台、(7).x86 SoC ASIC。仍將本著一貫務實、專注及創新的精神，面對問題、解決問題，實實在在的做好各項基礎功，逐步建立公司長期獲利的模式，以符合市場期待，進而增進股東權益。

本公司 113 年度營業收入為新台幣 424,695 仟元，較 112 年度之營業收入 301,777 仟元增加 40.73 %，112 年度之稅後淨損 115,236 仟元，113 年稅後淨損金額新台幣 24,114 仟元，每股稅後虧損為 0.34 元。

本公司於 113 年度持續於 x64 out of order CPU 新架構開發，務求於 114 年度能 Tape out x64 12nm 晶片；113 年度持續投資研發費用 246,757 仟元，約佔營收的 58 %，較 112 年度增加 15.85%，增加的部分主要為人力及軟硬體設備。研發除提升公司產品的效能及擴大應用外，亦大幅提升公司的技術能力，未來公司仍將持續擴大投資維持競爭力。

展望 114 年的發展，除儘快完成工業電腦客戶 28nm ASIC 及 5G 基地台 28nm Tape out 量產外，全力開發 64 位元 CPU 及 PCIe Switch 芯片，藉此打入 x86 主要營收市場，公司將更有機會藉此擴大客戶群及營收，在開發新案時亦持續投注大量資源於研發，希冀能把握住每個成長的契機，為股東創造最大利益。

本公司全體經營團隊非常感謝所有的客戶、供應商及各位股東之支持，期盼更多的投資大眾、業界先進繼續給予金麗支持與鼓勵，金麗全體員工將以最大的努力，積極開發新產品及拓展業務，在未來年度將能開始展現過去幾年開發的成果，創造輝煌佳績，重返榮耀，以更大成果分享全體股東。

敬祝 各位股東女士、先生身體健康 萬事如意

董事長暨總經理 ： 易建男

貳、 公司治理報告

一、董事、監察人、總經理、副總經理、協理、各部門及分支機構主管資料：

(一) 董事資料

1.董事資料

114 年 4 月 19 日；單位：股；%

職稱	國籍或註冊地	姓名	性別年齡	選任日期	任期	初次選任日期	選任時持有股份		現在持有股份		配偶、未成年子女現在持有股份		利用他人名義持有股份		主要經(學)歷	目前兼任本公司及其他公司之職務	具配偶或二親等以內關係之其他主管、董事或監察人			備註
							股數	持股比率%	股數	持股比率%	股數	持股比率%	股數	持股比率%			職稱	姓名	關係	
董事長	中華民國	易建男	男 61~70	111/6	3年	87/7	3,298,937	4.87	3,399,602	4.84	0	0.00	0	0.00	台灣大學電機研究所碩士 國科會P7 CPU技術審查委員 美國Silicon Plus公司P6 CPU Architecture & senior Designer	金麗科技(股)公司執行長暨總經理	無	無	無	註
董　事	中華民國	陳有諒	男 71~75	111/6	3年	96/6	1,840,308	2.71	1,895,517	2.70	0	0.00	0	0.00	台大電機系學士 蔚華系統(股)公司董事長 金麗科技(股)公司董事長	蔚華科技(股)公司董事、波若威科技(股)公司董事、李洲科技(股)公司董事、緯創資通(股)公司獨立董事	無	無	無	無
董　事	中華民國	呂理達	男 71~75	111/6	3年	96/6	1,299,089	1.92	1,338,061	1.90	0	0.00	0	0.00	交大電子物理學學士 UCLA電機工程所碩士、UCLA MBA 工研院電子所-市場部經理 宏碁-歐洲區總經理 德碁半導體股份有限公司執行副總 揚智-董事長 宏碁-經營暨投資管理事業總經理	台灣優燈(股)公司董事、宇瞻科技(股)公司董事、碩天科技(股)公司董事	無	無	無	無
董　事	中華民國	胡鈞陽	男 61~70	111/6	3年	99/6	1,255,617	1.85	1,293,285	1.84	15,732	0.02	0	0.00	交大電子研究所碩士 聯華電子(股)公司事業部經理	聯陽半導體(股)公司董事長、宇智網通(股)公司獨立董事	無	無	無	無
董　事	中華民國	詹顯德	男 51~60	111/6	3年	99/6	1,000,000	1.48	1,030,000	1.47	0	0.00	0	0.00	大華技術學院電子工程系 台灣發展研究院智能機器人研究所研究員	昭營科技(股)公司董事長	無	無	無	無
獨立董事	中華民國	林進財	男 61~70	111/6	3年	93/6	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	國立台灣大學商學碩士 美國銀行副總經理 瑞士銀行Managing Director、 中華民國銀行公會風險管理委員會主任委員(創設人)、大眾銀行總經理 緯創資通集團總財務長	無	無	無	無	無

職稱	國籍或註冊地	姓名	性別年齡	選任日期	任期	初次選任日期	選任時持有股份		現在持有股份		配偶、未成年子女現在持有股份		利用他人名義持有股份		主要經(學)歷	目前兼任本公司及其他公司之職務	具配偶或二親等以內關係之其他主管、董事或監察人			備註
							股數	持股比率%	股數	持股比率%	股數	持股比率%	股數	持股比率%			職稱	姓名	關係	
獨立董事	中華民國	張世穎	男 51~60	111/6	3年	105/6	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	雲林科技大學機械工程系暨研究所所長兼系主任、所長 國立雲林科技大學產業機械關鍵技術研發中心主任 國立雲林科技大學教務處課程及教學組組長 國立雲林科技大學教學卓越中心行政協調組組長 工業技術研究院機械所微系統技術部研究員 國立台灣大學材料工程學系博士後研究員 德國錫根大學材料工程研究所研究員	國立雲林科技大學機械工程系教授	無	無	無	無
獨立董事	中華民國	張郁禮	男 61~70	111/6	3年	111/6	29,000	0.04	0	0.00	0	0.00	0	0.00	PhD Physics, Clemson University, SC, USA Avatar Integrated System Inc., GM Asia 揚智科技股份有限公司全球業務副總 Cadence Design Systems Inc., GM Taiwan 網進科技股份有限公司總經理 優訊科技股份有限公司全球業務副總 Avant!, Corp. GM Taiwan HP, EDA PM	華釜科技(股)公司董事長 天擎積體電路(股)公司獨立董事	無	無	無	無
獨立董事	中華民國	蕭錫錬	男 51~60	111/6	3年	111/6	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	國立清華大學電機工程系博士 國立清華大學材料科學與工程學系博士後研究員 同步輻射研究中心研究助理	東海大學應用物理學系副教授	無	無	無	無

註：總經理與董事長為同一人，其原因、合理性、必要性及因應措施之相關資訊：

本公司董事長兼任總經理，係為提升經營效率與決策執行力，惟為強化公司治理，董事長平時亦密切與各董事充分溝通公司營運近況與計劃方針，且積極培訓合適人選。目前具體措施如下：

(1). 現任獨立董事分別在財務會計與科技產業領域學有專精，能有效發揮與監督職能。

(2). 每年度安排各董事參加證基會等外部機構專業董事課程，以增進董事會之運作效能。

(3). 獨立董事在各功能性委員會皆能充分討論並提出建議供董事會參考，以落實公司治理。

(4). 董事會成員中過半數董事並未兼任員工或經理人。

(5). 已於 111 年設置獨立董事人數四人。

2.董事專業資格及獨立董事獨立性資訊揭露：

條件 姓名	專業資格與經驗(註 1)	獨立性情形(註 2)	兼任其他公開發行公司獨立董事家數
易建男	・擔任金麗科技(股)公司董事長暨總經理。 ・具備多元產業之專業以及企業經營管理能力。 ・未有公司法第 30 條各款情事之一。	不適用	0
陳有諒	・擔任多家電子科技及半導體產業公司董事長及董事，如蔚華科技(股)公司董事長、緯創資通(股)公司獨立董事等。 ・具備多元產業之專業，以及企業經營管理能力。 ・未有公司法第 30 條各款情事之一。	不適用	1
呂理達	・曾擔任多家電子科技或半導體公司高階主管，如宏碁、德碁、揚智等。 ・具備多元產業之專業，以及企業經營管理能力。 ・未有公司法第 30 條各款情事之一。	不適用	0
胡鈞陽	・目前為聯陽半導體(股)公司董事長與宇智網通(股)公司獨立董事。 ・具備半導體與多元產業之專業，以及企業經營管理能力。 ・未有公司法第 30 條各款情事之一。	不適用	1
詹顯德	・現為昭營科技(股)公司董事長。 ・具備多元產業之專業，以及企業經營管理能力。 ・未有公司法第 30 條各款情事之一。	不適用	0
林進財	・曾任國外銀行總經理，退休於緯創資通集團總財務長一職。 ・具備完整會計及財務分析能力，並擁有多元產業之專業，以及企業經營管理能力。 ・未有公司法第 30 條各款情事之一。	・本公司獨立董事，符合獨立性情形。 ・獨立董事本人、其配偶、其二親等以內親屬未擔任本公司或其關係企業之董事、監察人或受僱人；未持有本公司股份；未擔任與本公司有特定關係公司之董事、監察人或受僱人。 ・最近 2 年無提供本公司或其他關係企業商務、法務、財務、會計等服務而取得報酬之情形。	0
張世穎	・現任國立雲林科技大學機械工程系教授及擔任金麗科技獨立董事。 ・具備公司業務所需之專業經驗。 ・未有公司法第 30 條各款情事之一。	・本公司獨立董事，符合獨立性情形。 ・獨立董事本人、其配偶、其二親等以內親屬未擔任本公司或其關係企業之董事、監察人或受僱人；未持有本公司股份；未擔任與本公司有特定關係公司之董事、監察人或受僱人。 ・最近 2 年無提供本公司或其他關係企業商務、法務、財務、會計等服務而取得報酬之情形。	0
張郁禮	・曾擔任國內外多家半導體公司高階主管，如 Avatar、揚智、Cadence 等公司。 ・具備多元產業之專業，以及企業經營管理能力。 ・未有公司法第 30 條各款情事之一。	・本公司獨立董事，符合獨立性情形。 ・獨立董事本人、其配偶、其二親等以內親屬未擔任本公司或其關係企業之董事、監察人或受僱人；未持有本公司股份；未擔任與本公司有特定關係公司之董事、監察人或受僱人。 ・最近 2 年無提供本公司或其他關係企業商務、法務、財務、會計等服務而取得報酬之情形。	1

蕭錫錬	・現任東海大學應用物理學系副教授。 ・具備公司業務所需之專業經驗。 ・未有公司法第 30 條各款情事之一。	・本公司獨立董事，符合獨立性情形。 ・獨立董事本人、其配偶、其二親等以內親屬未擔任本公司或其關係企業之董事、監察人或受僱人；未持有本公司股份；未擔任與本公司有特定關係公司之董事、監察人或受僱人。 ・最近 2 年無提供本公司或其他關係企業商務、法務、財務、會計等服務而取得報酬之情形。	0

註 1：專業資格與經驗：敘明個別董事及監察人之專業資格與經驗，如屬審計委員會成員且具備會計或財務專長者，應敘明其會計或財務背景及工作經歷，另說明是否未有公司法第 30 條各款情事。

註 2：獨立董事應敘明符合獨立性情形，包括但不限於本人、配偶、二親等以內親屬是否擔任本公司或其關係企業之董事、監察人或受僱人；本人、配偶、二親等以內親屬(或利用他人名義)持有公司股份數及比重；是否擔任與本公司有特定關係公司(參考公開發行公司獨立董事設置及應遵循事項辦法第 3 條第 1 項 5~8 款規定)之董事、監察人或受僱人；最近 2 年提供本公司或其關係企業商務、法務、財務、會計等服務所取得之報酬金額。

3.董事會多元化及獨立性：

(1)董事會多元化：

本公司於 112 年訂定「公司治理實務守則」，在第三章「強化董事會職能」即擬定有多元化方針，董事會成員之選任均以用人唯才為原則，宜具備跨產業領域之多元互補能力，包括基本組成（如：年齡、性別等）、產業經驗與相關技能（如：會計、財務、科技等）。為強化董事會職能達到公司治理理想目標，本公司「公司治理實務守則」第 24 條明載董事會整體應具備之能力如下：

1.營運判斷能力 2.會計及財務分析能力 3.經營管理能力 4.危機處理能力

5.產業知識 6.國際市場觀 7.領導能力 8.決策能力。

本公司管理目標為，獨立董事不少於三人且不得少於董事席次三分之一、兼任公司經理人之董事不宜逾董事席次三分之一以及至少包含一名女性董事。公司現任董事會設置九席董事(含四席獨立董事)，其中獨立董事占 44%、2 名董事具員工身份占 22%，尚無女性董事。本公司注重董事會成員組成之性別平等及多元互補專業能力，董事會多元化將以未來兩屆董事改選後之女性董事至少 1 席或增加不同領域專業董事為目標。

本公司董事會成員由產業、學術單位及財務會計等領域專家所組成，專業背景涵蓋電子、半導體、財務及管理產業經驗，具備本公司所需要之產業知識、營運判斷能力、國際市場觀念、領導能力與決策能力等，可以自不同角度給予專業意見，可以提升公司經營績效與管理效益。

本公司現任董事會成員多元政策及落實情形如下：

- 具員工身份之董事占比為 22%、獨立董事占比為 44%。
- 董事年齡 71 歲以上 2 位、61~70 歲 4 位、51~60 歲 3 位。
- 董事任期年資 10 年以上 6 位、3~9 年 3 位。

多元化核心項目 董事姓名	國籍	基本條件及價值						具備之能力							
		性別	兼任本公司員工	年齡			獨立董事任期年資	營運判斷能力	會計及財務分析能力	經營管理能力	危機處理能力	產業知識	國際市場觀	領導能力	決策能力
				51至60歲	61至70歲	71至75歲	6年~								
易建男	中華民國	男	V		V			V		V	V	V	V	V	V
陳有諒		男	V			V		V		V	V	V	V	V	V
呂理達		男				V		V		V	V	V	V	V	V
胡鈞陽		男			V			V		V	V	V	V	V	V
詹顯德		男		V				V		V	V	V	V	V	V
林進財		男			V		V	V	V	V	V	V	V	V	V
張世穎		男		V			V	V			V	V	V	V	V
張郁禮		男			V			V		V	V	V	V	V	V
蕭錫錬		男		V				V			V	V	V	V	V

(2)董事會獨立性：

本公司現任共有 9 席董事，包含 4 席獨立董事及 2 位具員工身份董事(佔全體董事成員比例 44%及 22%)。獨立董事均符合金融監督管理委員會證券期貨局有關獨立董事之規範，且各董事及獨立董事間無證券交易法第 26 條之 3 規定第 3 項及第 4 項規定情事，本公司董事會具獨立性(請參閱本年報第 4~5 頁董事專業資格及獨立董事獨立性資訊揭露)，各董事經學歷、性別及工作經驗(請參閱本年報第 2~3 頁董事資料)。

(二) 總經理、副總經理、協理、各部門及分支機構主管

114 年 4 月 19 日

職稱	國籍	姓名	性別	就任日期	持有股份		配偶、未成年子女持有股份		利用他人名義持有股份		主要經(學)歷	目前兼任其他公司職務	具配偶或二親等以內關係之經理人			備註
					股數	持股比率%	股數	持股比率%	股數	持股比率%			職稱	姓名	關係	
總經理兼執行長	中華民國	易建男	男	107/8	3,399,602	4.84	0	0.00	0	0.00	台灣大學電機研究所碩士 國科會 P7 CPU 技術審查委員 美國 Silicon Plus 公司 P6 CPU Architecture & senior Designer	註 1	無	無	無	註 2
財務處處長	中華民國	呂世民	男	87/4	536,482	0.76	34,202	0.05	0	0.00	逢甲大學會計系畢 匯元開發(股)公司財務部經理 遠東百貨總公司稽核主任	無	無	無	無	無

註 1：副總經理暨自動化事業群總經理及研發主管由現任董事長 易建男先生兼任。

註 2：總經理與董事長為同一人，其原因、合理性、必要性及因應措施之相關資訊：

本公司董事長兼任總經理，係為提升經營效率與決策執行力，惟為強化公司治理，董事長平時亦密切與各董事充分溝通公司營運近況與計劃方針，且積極培訓合適人選。目前具體措施如下：

1. 現任獨立董事分別在財務會計與科技產業領域學有專精，能有效發揮與監督職能。
2. 每年度安排各董事參加證基會等外部機構專業董事課程，以增進董事會之運作效能。
3. 獨立董事在各功能性委員會皆能充分討論並提出建議供董事會參考，以落實公司治理。
4. 董事會成員中過半數董事並未兼任員工或經理人。
5. 已於 111 年設置獨立董事人數四人。

(三) 最近年度支付董事、監察人、總經理及副總經理之酬金

1. 一般董事及獨立董事之酬金

單位：新台幣仟元

職稱	姓名	董事酬金								A、B、C及D等四項總額及占稅後純益之比例		兼任員工領取相關酬金								A、B、C、D、E、F及G等七項總額及占稅後純益之比例(%)		領取來自子公司以外轉投資事業或母公司酬金
		報酬(A)		退職退休金(B)		董事酬勞(C)		業務執行費用(D)				薪資、獎金及特支費等(E)		退職退休金(F)		員工酬勞(G)						
																本公司		財務報告內所有公司				
		本公司	財務報告內所有公司	本公司	財務報告內所有公司	本公司	財務報告內所有公司	本公司	財務報告內所有公司	本公司	財務報告內所有公司	本公司	財務報告內所有公司	本公司	財務報告內所有公司	現金金額	股票金額	現金金額	股票金額	本公司	財務報告內所有公司	
董事長	易建男	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3,500	3,500	—	—	—	—	—	—	3,500 (14.51%)	3,500 (14.51%)	—
董事	陳有諒	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	384	384	—	—	—	—	—	—	384 (1.59%)	384 (1.59%)	—
董事	呂理達	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
董事	胡鈞陽	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
董事	詹顯德	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
獨立董事	林進財	600	600	—	—	—	—	—	—	600 (2.49%)	600 (2.49%)	—	—	—	—	—	—	—	—	600 (2.49%)	600 (2.49%)	—
獨立董事	張世穎	600	600	—	—	—	—	—	—	600 (2.49%)	600 (2.49%)	—	—	—	—	—	—	—	—	600 (2.49%)	600 (2.49%)	—
獨立董事	張郁禮	600	600	—	—	—	—	—	—	600 (2.49%)	600 (2.49%)	—	—	—	—	—	—	—	—	600 (2.49%)	600 (2.49%)	—
獨立董事	蕭錫錬	600	600	—	—	—	—	—	—	600 (2.49%)	600 (2.49%)	—	—	—	—	—	—	—	—	600 (2.49%)	600 (2.49%)	—

1. 獨立董事酬金給付政策、制度、標準與結構，並依所擔負之職責、風險、投入時間等因素敘明與給付酬金數額之關聯性：
   本公司獨立董事酬金除參酌董事績效評估所得之評估結果外，另依據本公司章程第37條之1之規定，由薪資報酬委員會審議各董事對公司營運參與程度及貢獻價值，將績效風險之合理公平性與所得報酬連結，並參酌公司營運績效暨同業通常水準支給情形後提出建議提交董事會決議。
2. 除上表揭露外，最近年度公司董事為財務報告內所有公司提供服務(如擔任母公司/財務報告內所有公司/轉投資事業非屬員工之顧問等)領取之酬金：無。

註：係經 114/3/5 董事會通過之擬議分派數。

2.總經理及副總經理之酬金

單位：新台幣仟元

職稱	姓名	薪資(A)		退職退休金(B)		獎金及特支費等(C)		員工酬勞(D)				A、B、C及D等四項總額及占稅後純益之比例(%)		領取來自子公司以外轉投資事業或母公司酬金
		本公司	財務報告內所有公司	本公司	財務報告內所有公司	本公司	財務報告內所有公司	本公司		財務報告內所有公司		本公司	財務報告內所有公司	
								現金金額	股票金額	現金金額	股票金額			
總經理兼執行長	易建男	3,500	3,500	—	—	—	—	—	—	—	—	3,500 (14.51%)	3,500 (14.51%)	無

註：係經 114/3/5 董事會通過之擬議分派數。

3.上市上櫃公司前五位酬金最高主管之酬金

單位：新台幣仟元

職稱	姓名	薪資(A)		退職退休金(B)		獎金及特支費等(C)		員工酬勞(D)				A、B、C及D等四項總額及占稅後純益之比例(%)		領取來自子公司以外轉投資事業或母公司酬金
		本公司	財務報告內所有公司	本公司	財務報告內所有公司	本公司	財務報告內所有公司	本公司		財務報告內所有公司		本公司	財務報告內所有公司	
								現金金額	股票金額	現金金額	股票金額			
總經理兼執行長	易建男	3,500	3,500	—	—	—	—	—	—	—	—	3,500 (14.51%)	3,500 (14.51%)	—
財務處處長	呂世民	2,416	2,416	138	138	—	—	—	—	—	—	2,554 (10.60%)	2,554 (10.60%)	—
公司治理主管	陳沼惠	1,524	1,524	112	112	—	—	—	—	—	—	1,636 (6.78%)	1,636 (6.78%)	—

註 1：係經 114/3/5 董事會通過之擬議分派數。

註 2：上述列示主管係指公司經理人。

註 3：公司前五位酬金最高者，除總經理外，係非經理人之資深同仁，隸屬設計開發及技術服務部門。

4.分派員工酬勞之經理人姓名及分派情形：

職稱		姓名	股票金額	現金金額	總計	總額占稅後純益之比例(%)
經理人	總經理兼執行長	易建男	—	—	—	—
	財務處處長	呂世民				
	公司治理主管	陳沼惠				

註：係經 114/3/5 董事會通過之擬議分派數。

(四) 本公司最近二年度支付本公司董事、監察人、總經理及副總經理酬金總額占稅後純益比例之分析並說明給付酬金之政策、標準與組合、訂定酬金之程序、與經營績效及未來風險之關聯性：

酬金總額占稅後純益比例	112 年度	113 年度
董事	(5.36%)	(26.06%)
總經理及副總經理	(3.04%)	(14.51%)

1. 本公司於支付董事、監察人、酬金總額占稅後純益比例如上述，係因酬金之政策、標準、組合及訂定酬金之程序皆依據本公司章程之規定提撥，提交董事會核准後再呈股東會同意。

(1).本公司董事酬勞分派政策係依本公司章程第三十七條及三十七條之一規定，於本公司年度總決算如有盈餘，應先提繳稅款、彌補以往虧損，次提百分之十為法定盈餘公積，如有餘額，應以不高於當年度獲利狀況之百分之三分派，由董事會決議行之，並報告股東會。

(2).本公司總經理及副總經理酬勞係依公司法第二十九條規定，由董事會決議之。分派員工酬勞則依本公司章程第三十七條及三十七條之一規定，於本公司年度總決算如有盈餘，應先提繳稅款、彌補以往虧損，次提百分之十為法定盈餘公積，如有餘額，應以當年度獲利狀況之百分之八至三十，由董事會決議行之，並報告股東會。

2.酬金之發放，除了兼任員工之固定薪資及獨立董事之固定報酬外，其餘部份與經營績效及未來風險之關聯性呈正相關。

二、公司治理運作情形

(一) 董事會運作情形資訊

最近年度(113 年度)董事會開會 6 次(A)，董事及監察人出列席情形如下：

職稱	姓名(註1)	實際出(列)席次數B	委託出席次數	實際出(列)席率(%)【B/A】	備註
董事	陳有諒	5	1	83%	
董事	呂理達	2	3	33%	
董事長	易建男	6	0	100%	
董事	胡鈞陽	6	0	100%	
董事	詹顯德	6	0	100%	
獨立董事	林進財	6	0	100%	
獨立董事	張世穎	6	0	100%	
獨立董事	張郁禮	6	0	100%	
獨立董事	蕭錫錬	5	0	83%	

其他應記載事項：

一、董事會之運作如有下列情形之一者，應敘明董事會日期、期別、議案內容、所有獨立董事意見及公司對獨立董事意見之處理：

(一)證券交易法第14條之3所列事項：本公司已設置審計委員會，故不適用。

(二)除前開事項外，其他經獨立董事反對或保留意見且有紀錄或書面聲明之董事會議決事項：本公司無此情形。

二、董事對利害關係議案迴避之執行情形，應敘明董事姓名、議案內容、應利益迴避原因以及參與表決情形：

(一) 113/10/14 第十屆第十四次董事會第四案討論訂定民國 113 年度第一次私募普通股增資基準日、數量及價格案，因獨立董事張郁禮同時擔任天擎積體電路股份有限公司獨立董事，涉及自身利益，予以迴避討論且未參與討論及表決，其餘出席董事一致同意照案通過。

(二) 113/10/14 第十屆第十四次董事會第六案討論審核董事次年度薪酬計畫案，因涉及獨立董事林進財、張世穎、張郁禮、蕭錫錬自身利益，予以迴避討論且未表決；另經陳有諒董事及胡鈞陽董事提議，考量兼任功能性委員會「主席」之獨立董事需承擔較多工作與責任，應給予職務加給，本案除依法迴避未參與討論及表決之董事外，其餘出席董事一致同意通過。

(三) 113/10/14 第十屆第十四次董事會第七案討論審核經理人績效評估及年度調薪計畫，因董事長易建男同時兼任執行長涉及自身利益，予以迴避且未參與討論及表決，其餘出席董事一致同意照案通過。

三、董事會自我(或同儕)評鑑之評估週期及期間、評估範圍、方式及評估內容等資訊，詳下表。

四、當年度及最近年度加強董事會職能之目標（例如設立審計委員會、提昇資訊透明度等）與執行情形評估：

(一)秉持營運資訊透明及維護股東權益，主動於公司網站揭露董事會重要決議等相關訊息。

(二)主動提供各類進修課程資訊亦鼓勵董事踴躍參加各項公司治理課程，以加強董事職能，113 年度董事進修共 9 人，總計 54 小時。

(三)為落實公司治理，本公司於 108/10/30 通過董事會績效評估辦法之訂定，並已於 109 年起實施董事會績效評估。

董事會評鑑執行情形

評估週期	評估期間	評估範圍	評估方式	評估內容
每年執行一次	113/1/1~113/12/31	・董事會 ・個別董事成員 ・功能性委員會(審計委員會與薪酬委員會)	・董事會內部自評 ・董事成員自評 ・功能性委員會(審計委員會與薪酬委員會)自評	1.董事會績效評估衡量項目，包含下列五大面向： ・對公司營運之參與程度 ・提升董事會決策品質 ・董事會組成與結構 ・董事之選任及持續進修 ・內部控制等 2.個別董事成員績效評估項目，包含下列六大面向： ・公司目標與任務之掌握 ・董事職責認知 ・對公司營運之參與程度 ・內部關係經營與溝通 ・董事之專業及持續進修 ・內部控制等 3.功能性委員會(審計委員會與薪酬委員會)績效評估項目，包含下列五大面向： ・對公司營運之參與程度 ・功能性委員會職責認知 ・功能性委員會決策品質 ・功能性委員會組成及成員選任 ・內部控制等

1.本公司已完成民國 113 年度董事會暨功能性委員會(審計委員會與薪酬委員會)績效自評，評估結果已提送民國 114 年第一季董事會報告，作為檢討及改進之依據。

2.民國 113 年董事會暨功能性委員會(審計委員會與薪酬委員會)績效評估指標達成率顯示績效優良，符合公司治理之成果。

(二) 審計委員會運作情形：

本公司於105年6月3日設置審計委員會，最近年度(113年度)審計委員會開會5次(A)，獨立董事出列席情形如下：

職稱	姓名	實際出(列)席次數B	委託出席次數	實際出(列)席率(%)【B/A】	備註
獨立董事	林進財	5	0	100%	
獨立董事	張世穎	5	0	100%	
獨立董事	張郁禮	5	0	100%	
獨立董事	蕭錫錬	5	0	100%	

其他應記載事項：

一、審計委員會之運作如有下列情形之一者，應敘明審計委員會召開日期、期別、議案內容、獨立董事反對意見、保留意見或重大建議項目內容、審計委員會決議結果以及公司對審計委員會意見之處理：

(一)證券交易法第 14 條之 5 所列事項：

審計委員會日期	議案內容	審計委員會決議結果	公司對審計委員會意見之處理
113/03/06	1.承認 112 年度營業報告書及財務報告。 2.112 年度虧損撥補議案。 3.內部控制制度有效性考核及內部控制制度聲明書案 4.113 年度簽證會計師委任、報酬與其獨立性及適任性評估案。 5.擬購置供專案使用之無形資產(IP)採購案	全體出席獨立董事一致同意照案通過	無
113/04/30	1.113 年第一季財務報告案。 2.113 年擬以私募方式增資發行新股案	全體出席獨立董事一致同意照案通過	無
113/08/09	1.重編 110 年第一季至 111 年第三季財務報告及更正 109 年度、111 年度、112 年第一季至 113 年第一季財務報告。 2.重編 110 年度營業報告書及盈餘分派案。 3.113 年第二季財務報告案。	全體出席獨立董事一致同意照案通過	無
113/09/25	1.擬購置供專案使用之無形資產(IP)採購案	全體出席獨立董事一致同意照案通過	無
113/10/30	1.民國 113 年第三季財務報告案 2.修訂本公司內部控制制度及內部稽核實施細則「永續資訊之管理」暨作業辦法「永續資訊管理作業辦法」案。 3.民國 114 年度稽核計畫案。 4.訂定民國 113 年度第一次私募普通股增資基準日、數量及價格案。	全體出席獨立董事一致同意照案通過	無

(二)除前開事項外，其他未經審計委員會通過，而全體董事三分之二以上同意之議決事項：本公司無此情形。

二、獨立董事對利害關係議案迴避之執行情形，應敘明獨立董事姓名、議案內容、應利益迴避原因以及參與表決情形：本公司無此情形。

三、獨立董事與內部稽核主管及會計師之溝通情形(應包括就公司財務、業務狀況進行溝通之重大事項、方式及結果等)：

本公司內部稽核單位除每月將稽核報告及查核缺失改善追蹤報告送交獨立董事外，內部稽核主管定期於每季至少一次召開之審計委員會、每年與獨立董事單獨之座談會，向獨立董事進行稽核業務及稽核結果與其追蹤情形說明。

本公司簽證會計師於每季審計委員會議，針對本公司財務報表核閱或查核結果、內控查核、IFRSs 公報修訂與發佈對公司之影響及其他相關法令要求事項，向獨立董事進行報告，並就有無財報調整分錄或法令修訂是否影響帳列方式進行溝通。

稽核主管及會計師與獨立董事平時得就公司財務、業務狀況隨時得視需要直接互相聯繫，如有重大事項亦可隨時召集會議，以進行溝通及了解。

獨立董事與會計師與內部稽核主管之溝通情形：

日期	出席人員	溝通事項	溝通結果
113/03/06 審計委員會	獨立董事林進財 獨立董事張世穎 獨立董事張郁禮 獨立董事蕭錫錬 會計師　劉倩瑜 會計師　謝智政	1.112 年第 4 季內部稽核業務執行報告 2.討論 112 年度「內部控制制度聲明書」	1.知悉，無其他建議事項 2.審議通過後提報董事會

113/04/30 審計委員會	獨立董事張世穎 獨立董事張郁禮 獨立董事蕭錫錬 會計師　劉倩瑜	113 年第 1 季內部稽核業務執行報告	知悉，無其他建議事項
113/08/09 審計委員會	獨立董事林進財 獨立董事張世穎 獨立董事張郁禮 獨立董事蕭錫錬 會計師　劉倩瑜	113 年第 2 季內部稽核業務執行報告	知悉，無其他建議事項
113/10/30 審計委員會	獨立董事林進財 獨立董事張世穎 獨立董事張郁禮 獨立董事蕭錫錬 會計師　劉倩瑜 會計師　謝智政	1.113 年第 3 季內部稽核業務執行報告 2.討論 114 年度「內部稽核計畫」	1.知悉，無其他建議事項 2.審議通過後提報董事會
114/03/05 座談會	獨立董事林進財 獨立董事張世穎 獨立董事張郁禮 獨立董事蕭錫錬 會計師　劉倩瑜 會計師　謝智政	1.113 年度內部稽核業務執行結果報告 2.依循且不違反證期局發布「上市櫃公司內部控制常見缺失」說明	知悉，無其他建議事項
114/03/05 審計委員會	獨立董事林進財 獨立董事張世穎 獨立董事張郁禮 獨立董事蕭錫錬 會計師　劉倩瑜 會計師　謝智政	1.113 年第 4 季內部稽核業務執行報告 2.討論 113 年度「內部控制制度聲明書」	1.知悉，無其他建議事項 2.審議通過後提報董事會

四、審計委員會年度工作重點及運作情形:

本委員會之運作以監督公司於有關稽核、會計、財報表達流程及財務控制上的執行品質及誠信度。

(一)主要年度工作重點：

1. 依證交法第十四條之一訂定或修正內部控制制度。
2. 內部控制制度有效性之考核。
3. 依證交法第三十六條之一訂定或修正取得或處分資產、從事衍生性商品交易、資金貸與他人、為他人背書或提供保證之重大財務業務行為相關處理程序。
4. 涉及董事自身利害關係之事項。
5. 重大之資產或衍生性商品交易。
6. 重大之資金貸與、背書或提供保證。
7. 募集、發行或私募具有股權性質之有價證券。
8. 簽證會計師之委任、解任或報酬。
9. 財務、會計或內部稽核主管之任免。
10. 年度財務報告及半年度財務報告。
11. 其他本公司或主管機關規定之重大事項。

(二)當年度運作情形：如上第一項(一)所載。

註 1：年度終了日前有獨立董事離職者，應於備註欄註明離職日期，實際出席率(%)則以其在職期間審計委員會開會次數及其實際出席次數計算之。

註 2：年度終了日前，有獨立董事改選者，應將新、舊任獨立董事均予以填列，並於備註欄註明該獨立董事為舊任、新任或連任及改選日期。實際出席率(%)則以其在職期間審計委員會開會次數及其實際出席次數計算之。

(三) 公司治理運作情形及與上市上櫃公司治理實務守則差異情形及原因

評估項目	運作情形(註1)			與上市上櫃公司治理實務守則差異情形及原因
	是	否	摘要說明	
一、公司是否依據「上市上櫃公司治理實務守則」訂定並揭露公司治理實務守則？	V		本公司已訂定「金麗科技股份有限公司公司治理實務守則」，置於本公司網站公司治理專區，提供相關利害關係人參閱下載。 請參閱本公司網址 https://www.rdc.com.tw/index.php?route=ir/issue_rules。	無。
二、公司股權結構及股東權益				
（一）公司是否訂定內部作業程序處理股東建議、疑義、糾紛及訴訟事宜，並依程序實施？		V	本公司未訂立內部作業程序，惟為確保股東權利，本公司設有專責人員處理股東建議、疑義及糾紛等事項。	將視實際營運研擬制定。
（二）公司是否掌握實際控制公司之主要股東及主要股東之最終控制者名單？	V		本公司可隨時掌握實際控制公司之主要股東名單，確保經營權之穩定性。	無
（三）公司是否建立、執行與關係企業間之風險控管及防火牆機制？	V		本公司已訂定「集團企業、特定公司與關係人交易作業程序」。	無
（四）公司是否訂定內部規範，禁止公司內部人利用市場上未公開資訊買賣有價證券？	V		本公司已訂定「員工從業道德守則」及「董事及經理人道德行為準則」嚴禁員工、董事及經理人利用未公開資訊買賣公司有價證券，董事亦定期進修公司治理相關課程，且訂有「內部重大資訊處理暨防範內線交易管理作業程序」，建立良好內部重大資訊處理及揭露機制，避免資訊不當揭露。	無
三、董事會之組成及職責				
（一）董事會是否擬訂多元化政策、具體管理目標及落實執行？	V		董事會成員組成多元化方針及落實執行，請參閱本年報第5~6頁之「董事會多元化及獨立性」。	無
（二）公司除依法設置薪資報酬委員會及審計委員會外，是否自願設置其他各類功能性委員會？		V	本公司未設置其他各類功能性委員會。	將視公司營運研擬訂定。
（三）公司是否訂定董事會績效評估辦法及其評估方式，每年並定期進行績效評估，且將績效評估之結果提報董事會，並運用於個別董事薪資報酬及提名續任之參考？	V		本公司業於108年10月30日經董事會通過訂定「董事會績效評估辦法」，並自109年起每年定期實施內部董事會績效評估；114年第一季已依董事會績效評估辦法執行113年度董事會、董事成員、功能性委員會(審計委員會及薪資報酬委員會)之績效評估，且將績效評估之結果提報董事會，作為個別董事薪資報酬及提名續任的參考。	無

評估項目	運作情形(註1)			與上市上櫃公司治理實務守則差異情形及原因
	是	否	摘要說明	
（四）公司是否定期評估簽證會計師獨立性？	V		本公司審計委員會每年定期評估簽證會計師之適任性與獨立性，再將評估結果提報董事會。最近一次評估經114/03/05審計委員會決議通過後，並提報114/03/05董事會決議通過。 公司評估機制如下： 1.遵守公司治理實務守則規定辦理簽證會計師之輪替。 2.定期取得會計師出具之獨立聲明書。 3.取得會計師事務所提供之13項審計品質指標(AQIs)資訊，並依據主管機關發布之「審計委員會解讀審計品質指標(AQI)指引」，評估會計師事務所及查核團隊之審計品質。(評估項目包含：會計師事務所規模與聲譽、簽證會計師學經歷、審計服務品質（如會計師負荷與查核投入以及事務所之品管管制）、非審計服務公費占比、公司獨立董事及相關高階主管與簽證會計師間是否獨立、是否未聘任曾擔任會計師事務所審計人員為公司高階財務主管或是其他有權影響重大決策人員、是否無重大審計違規及法律訴訟案件等。) 評估結果如下： 1.簽證會計師與本公司間之獨立性符合中華民國會計師法、會計師職業道德規範等相關規定。 2.本公司未連續五年委任同一會計師簽證。	無
四、上市上櫃公司是否配置適任及適當人數之公司治理人員，並指定公司治理主管，負責公司治理相關事務(包括但不限於提供董事、監察人執行業務所需資料、協助董事、監察人遵循法令、依法辦理董事會及股東會之會議相關事宜、製作董事會及股東會議事錄等)？	V		本公司業已設置公司治理主管，負責公司治理相關事務(包括但不限於提供董事執行業務所需資料、協助董事遵循法令、依法辦理董事會及股東會之會議相關事宜、製作董事會及股東會議事錄等)。	無
五、公司是否建立與利害關係人(包括但不限於股東、員工、客戶及供應商等)溝通管道，及於公司網站設置利害關係人專區，並妥適回應利害關係人所關切之重要企業社會責任議題？	V		本公司與往來銀行及其他債權人、員工、客戶、供應商均有暢通之溝通管道，並尊重其應有之合法權益，並於公司網站(www.rdc.tw)提供發言人資訊，妥適回應利害關係人所關切之重要企業社會責任議題。	無

評估項目	運作情形(註1)			與上市上櫃公司治理實務守則差異情形及原因
	是	否	摘要說明	
六、公司是否委任專業股務代辦機構辦理股東會事務？	V		本公司委託永豐金證券股份有限公司專業辦理股東會事務。	無
七、資訊公開				
（一）公司是否架設網站，揭露財務業務及公司治理資訊？	V		本公司網站(www.rdc.tw)設有專人維護更新，揭露財務、業務及公司治理之資訊，不定期更新以供投資人查閱。	無
（二）公司是否採行其他資訊揭露之方式（如架設英文網站、指定專人負責公司資訊之蒐集及揭露、落實發言人制度、法人說明會過程放置公司網站等）？	V		本公司已指定專人負責公司資訊蒐集及揭露工作，並已建立發言人制度。	無
（三）公司是否於會計年度終了後兩個月內公告並申報年度財務報告，及於規定期限前提早公告並申報第一、二、三季財務報告與各月份營運情形？		V	本公司113年度財務報告於會計年度終了後三個月內公告並申報；第一、二、三季財務報告與各月份營運情形已於規定期限前提前公告並申報。	財務報告公告皆於規定期限內申報完成。
八、公司是否有其他有助於瞭解公司治理運作情形之重要資訊（包括但不限於員工權益、僱員關懷、投資者關係、供應商關係、利害關係人之權利、董事及監察人進修之情形、風險管理政策及風險衡量標準之執行情形、客戶政策之執行情形、公司為董事及監察人購買責任保險之情形等）？	V		1.本公司秉持照顧員工之信念，除訂有休假、退休制度並設有多項福利措施。 2.本公司財務透明並定期透過公開資訊揭露營運狀況予投資人。 3.本公司逐年審核供應商績效，淘汰績效較差者，以確保供貨品質。 4.本公司設置發言人作為與利害關係人溝通管道。 5.本公司董事(含獨立董事)已依「上市上櫃公司治理實務守則」第四十條之規定，於任期中持續參加上櫃公司董事進修推行要點所指定機構舉辦涵蓋公司治理主題相關之進修課程並取得結業證明，113年度董事進修之情形請參閱本年報第34頁董事及監察人進修之情形。 6.本公司至少每季召開董事會一次，遇有緊急情事時並得隨時召集之，董事出席董事會狀況尚屬良好。 7.本公司業依法制定各種內部規章，進行各種風險管理及評估。 8.本公司已於內部控制制度制定「客訴處理作業」以保護客戶權益。 9.本公司董事對有利害關係之議案均有迴避。 10.本公司已為董事購買責任保險並已於公開資訊觀測站公告申報。	無

評估項目	運作情形(註1)			與上市上櫃公司治理實務守則差異情形及原因
	是	否	摘要說明	
九、請就臺灣證券交易所股份有限公司公司治理中心最近年度發布之公司治理評鑑結果說明已改善情形，及就尚未改善者提出優先加強事項與措施：無。				

(四) 公司如有設置薪酬委員會，應揭露其組成、職責及運作情形：

1.薪資報酬委員會成員資料：

114 年 4 月 19 日

條件 / 身分別 /姓名		專業資格與經驗	獨立性情形	兼任其他公開發行公司薪資報酬委員會成員家數
召集人(獨立董事)	林進財	請參閱第 4 頁 2. 董事專業資格及獨立董事獨立性資訊揭露相關內容。		0
委員(獨立董事)	張世穎			0
委員(獨立董事)	張郁禮			1
委員(獨立董事)	蕭錫錬			0

2.薪資報酬委員會職責範圍：

(1)定期檢討薪資報酬委員會組織規程並提出修正建議。

(2)訂定並定期檢討本公司董事、監察人及經理人年度及長期之績效目標與薪資報酬之政策、制度、標準與結構。

(3)定期評估本公司董事、監察人及經理人之績效目標達成情形，並訂定其個別薪資報酬之內容及數額。

3.薪資報酬委員會運作情形：

(1)本公司之薪資報酬委員會委員計 4 人。

(2)本屆委員任期：111 年 6 月 22 日至 114 年 6 月 21 日，最近年度(113 年)薪資報酬委員會開會 2 次(A)，委員資格及出席情形如下：

職稱	姓名(註1)	實際出(列)席次數B	委託出席次數	實際出(列)席率(%)【B/A】(註2)	備註
召集人	林進財	2	0	100%	• 其職權範圍之內容如上2.所述。
委員	張世穎	2	0	100%	
委員	張郁禮	2	0	100%	
委員	蕭錫錬	2	0	100%	

其他應記載事項：

一、董事會如不採納或修正薪資報酬委員會之建議，應敘明董事會日期、期別、議案內容、董事會決議結果以及公司對薪資報酬委員會意見之處理(如董事會通過之薪資報酬優於薪資報酬委員會之建議，應敘明其差異情形及原因)：無。

二、薪資報酬委員會之議決事項，如成員有反對或保留意見且有紀錄或書面聲明者，應敘明薪資報酬委員會日期、期別、議案內容、所有成員意見及對成員意見之處理：無。

註：

(1) 年度終了日前有薪資報酬委員會成員離職者，應於備註欄註明離職日期，實際出席率(%)則以其在職期間薪資報酬委員會開會次數及其實際出席次數計算之。

(2) 年度終了日前，有薪資報酬委員會改選者，應將新、舊任薪資報酬委員會成員均予以填列，並於備註欄註明該成員為舊任、新任或連任及改選日期。實際出席率(%)則以其在職期間薪資報酬委員會開會次數及其實際出席次數計算之。

4.提名委員會成員資料及運作情形資訊：不適用。

(五) 推動永續發展執行情形及與上市上櫃公司永續發展實務守則差異情形及原因：

推動項目	運作情形			與上市上櫃公司永續發展實務守則差異情形及原因
	是	否	摘要說明	
一、公司是否建立推動永續發展之治理架構，且設置推動永續發展專（兼）職單位，並由董事會授權高階管理階層處理，及董事會督導情形？	V		本公司業已指定專人兼職推動永續發展，由總經理室與各領域中、高階主管，共同檢視公司的核心營運能力，負責訂定中長期的永續發展計畫，並視需要成立任務小組，以辨識攸關公司營運與利害關係人所關注的永續議題，擬定相對應策略與工作方針、編列各組織與永續發展相關預算、規劃並執行年度方案，同時追蹤執行成效，確保永續發展策略充份落實於公司日常營運中。 董事會定期聽取經營團隊報告以了解公司管理作為，並適時給予建議。	無差異。
二、公司是否依重大性原則，進行與公司營運相關之環境、社會及公司治理議題之風險評估，並訂定相關風險管理政策或策略？	V		本公司參酌「永續經營實務守則」並秉持誠信與創新經營理念，在追求企業永續經營與獲利同時，落實公司治理，注重與公司營運相關之環境、社會與公司治理議題之風險評估，並視需要針對公司投資人及其他利害關係人產生重大影響之環境、社會及公司治理等議題，研擬相關風險管理策略及措施，將其納入公司管理方針與營運活動，以達永續經營之目標。	無差異。
三、環境議題				
（一）公司是否依其產業特性建立合適之環境管理制度？	V		本公司係無晶圓廠之IC設計業，晶圓製程皆為委外加工，除所銷售產品及包裝符合歐盟環保指令RoHS之規定，並建立通過ISO9001品質管理系統維護產品品質並設有專責人員負責環境安全衛生管理的維持與推行，以維護工作環境。	無差異。
（二）公司是否致力於提升能源使用效率及使用對環境負荷衝擊低之再生物料？	V		本公司致力推動節能減碳各項配套措施，以因應環境變化的衝擊。 1.落實節能減碳宣導: 對照明及空調開關處張貼海	無差異。

<table>
<tr><th rowspan="2">推動項目</th><th colspan="3">運作情形</th><th rowspan="2">與上市上櫃公司永續發展實務守則差異情形及原因</th></tr>
<tr><th>是</th><th>否</th><th>摘要說明</th></tr>
<tr><td></td><td>V</td><td></td><td>報標語，宣導節能減碳，鼓勵員工節約能源。
2.規劃及導入辦公室節能:
規劃採用節能LED照明燈具，目前部份區域試用測試中；每日上下班及中午休息時間進行開關管控，避免非必要的能源浪費。
3.資源利用與再生:
(1)辦公設備資源再利用
包含資訊電腦設備及電件，將可回收及拆解再利用，利用循環再生，降低環境負荷。
(2)包材回收再利用
依據包材性質進行分類管理，將進貨後之空紙箱，回收使用於出貨包裝上，減少對環境生態破壞。</td><td></td></tr>
<tr><td>（三） 公司是否評估氣候變遷對企業現在及未來的潛在風險與機會，並採取相關之因應措施？</td><td>V</td><td></td><td>全球暖化與氣候變遷所造成的極端氣候，已對世界與台灣造成衝擊，有限的能源資源使企業經營成本提升，也讓人類面臨前所未有的挑戰，故，必須積極落實節能策略，方能抵抗氣候變遷所帶來的衝擊。本公司為IC設計，主要使用能源為資訊設備之電力，其中又以空調用電為重，其次為公用設施用電。落實節能減碳，如管控閒置設備（含空調）用電，113年及112年總耗用量：
<table><tr><th>年度</th><th>總耗用量(仟度)</th></tr><tr><td>113年</td><td>4,478.1</td></tr><tr><td>112年</td><td>4,646.9</td></tr></table></td><td>無差異。</td></tr>
<tr><td>（四） 公司是否統計過去兩年溫室氣體排放量、用水量及廢棄物總重量，並制定溫室氣體減量、減少用水或其他廢棄物管理之政策？</td><td>V</td><td></td><td>本公司從事IC設計業，生產製程係委外，本身並無排放污染之情形；
1.每年二次作業環境二氧化碳濃度測定， 113年及112年檢測平均濃度分別為1038ppm及602 ppm，皆低於室內作業標準5000 ppm。
2.未來仍持續推動節能減碳、</td><td>無差異。</td></tr>
</table>

推動項目	運作情形			與上市上櫃公司永續發展實務守則差異情形及原因
	是	否	摘要說明	
			溫室氣體減量、減少用水或其他廢棄物管理政策，113年以持續降低用水用電及其他廢棄物為目標，期能達成環境永續發展之低碳企業。 3.其他相關說明請參閱註1。	
四、社會議題				
（一）公司是否依照相關法規及國際人權公約，制定相關之管理政策與程序？	V		本公司依據勞基法訂定退休辦法，為每位員工投保團體醫療保險，設置職工福利委員會辦理各項福利事項；制定性騷擾防治措施、申訴及懲誡管理辦法，保障員工合法權益。本公司依國際公認基本勞動人權原則，並於雇用政策上建立適當程序，確保無性別、種族、年齡、婚姻與家庭狀況等差別待遇，以落實報酬、雇用條件、訓練與升遷機會之平等。	無差異。
（二）公司是否訂定及實施合理員工福利措施（包括薪酬、休假及其他福利等），並將經營績效或成果適當反映於員工薪酬？	V		本公司遵循「勞動基準法」及相關法令訂定員工各項薪資福利措施，依據個人績效表現、職責承擔度及未來發展潛力，提供調薪、差異化獎金、員工酬勞制度及股票報酬並提供具市場競爭力的福利以激勵員工，此外定期考核，發放獎金，以當年度獲利狀況之百分之八至三十分派員工酬勞，與同仁共享盈餘成果。其他相關說明請參閱註2。	無差異
（三）公司是否提供員工安全與健康之工作環境，並對員工定期實施安全與健康教育？	V		本公司最重視即是員工，創造友善職場環境為首要工作： 1.工作環境及員工安全防護措施： (1)安排清潔人員每日維護職場環境，定期安排進行工作環境洗地消毒及空調清潔保養。 (2)依法規委請專業技師定期進行各項安全檢查及維護。 (3)員工出入辦公室需佩戴識別證，訪客或廠商由櫃台	無差異

推動項目	運作情形			與上市上櫃公司永續發展實務守則差異情形及原因
	是	否	摘要說明	
			引導，不得擅自進入。 (4)與保全公司簽約，大樓前後門設有24小時嚴密監控系統，以維護人員安全。 2.健康保護管理及推廣活動： (1)每年提供員工健檢，並進行健康教育宣導。 (2)定期安排勞安訓練及消防講習，以維員工生命安全。 (3)定期安排員工慶生會及年度員工旅遊活動，以促進員工身心健康及彼此情誼。 3.112及113全年度所有工作者皆無受傷失能案件，亦無職業病案例及無因公身故案例。 4.其他相關說明請參閱註3。	
（四）公司是否為員工建立有效之職涯能力發展培訓計畫？	V		本公司致力提供員工一個開放多元的學習環境，使同仁生涯與職涯相互結合，為員工職涯發展創造良好環境，並建立有效之職涯能力發展培訓計畫。	無差異
（五）針對產品與服務之顧客健康與安全、客戶隱私、行銷及標示等議題，公司是否遵循相關法規及國際準則，並制定相關保護消費者或客戶權益政策及申訴程序？	V		本公司客訴處理有一定流程並建立以客戶為導向之品質系統。本公司重視客戶意見，除個別拜訪外，亦於公司網站提供聯絡窗口及電子郵件信箱，另設置利害關係人專區，提供透明且有效之客戶申訴程序，藉此改善產品品質，確保客戶權益。	無差異
（六）公司是否訂定供應商管理政策，要求供應商在環保、職業安全衛生或勞動人權等議題遵循相關規範，及其實施情形？	V		本公司已訂定供應商管理辦法，促使供應商之物料能符合品質要求。 本公司定期對供應商傳遞永續理念及目標之外，亦針對評鑑良好之供應商(如品質提升、降低成本、確保交貨、永續表現等)會加強與其合作關係。	無差異
五、公司是否參考國際通用之報告書編製準則或指引，編製永續報告		V	本公司尚未編製永續報告書。	將依相關法規規定時程訂定。

推動項目	運作情形			與上市上櫃公司永續發展實務守則差異情形及原因
	是	否	摘要說明	
書等揭露公司非財務資訊之報告書？前揭報告書是否取得第三方驗證單位之確信或保證意見？				

六、公司如依據「上市上櫃公司永續發展實務守則」定有本身之永續發展守則者，請敘明其運作與所定守則之差異情形：本公司尚未訂定「上市上櫃公司永續發展實務守則」，將視公司營運需要訂定。

七、其他有助於瞭解推動永續發展執行情形之重要資訊：無。

註 1：

◆ 溫室氣體減量、減少用水或其他廢棄物管理政策，包含減量目標、推動措施及達成情形

➢ 推動環境永續政策

本公司為 IC 設計產業，委外加工，無晶圓廠，為善盡環境保護的一份心力，有計畫的制定節能減碳與減少用水及其他廢棄物管理之政策達成目標的實施措施如下：

節能減碳政策	照明及空調空間張貼海報標語隨手關燈，要求同仁會議結束或是下班冷氣需關閉，事務機、個人電腦螢幕設定休眠模式。定期安排冷氣保養及清潔濾網，提高效能。
	辦公區主要照明由原本傳統 T8 格柵燈具逐步分區汰換成 LED 平板燈具，每盞燈具節電效益由原本 92W/盞→30W/盞，藉由燈具汰換減少用電度數，提升節能減碳成效。
	依季節性變化，適時調節辦公室區域空氣，推行辦公室內溫度設定為攝氏 26 度，避免過度能源耗損。
	大環境的改變，節能減碳為電子零組件產品的必要訴求，本公司的產品為 IC，將持續開發出節能省電的產品為目標。
節能用水政策	宣導員工節約用水，在生活用水上加裝 3M 省水閥，節約民生水量。
	廁所馬桶汰換有經濟部水利署認可一級省水標章之產品。
廢棄物管理政策	全方位實施垃圾分類與回收政策，並使用對環境負荷衝擊低之再生物料，減少資源的浪費。
	透過定期回收作業讓資源能再次被使用達到資源回收再利用。 1.廢棄紙類水銷 2.廢 3C、資訊淘汰零組件、下腳料回收 3.IC Tray 盤回收

➢ 推動節能、節電、節水政策執行情形

本公司以永續經營自許，基於環境保護之企業使命，持續進行節能減碳措施，有效改善溫室氣體排放量及降低公司營運成本。在全球環境溫度持續失衡暖化過程中，因溫室氣體濃度增加，衝擊著對人類及環境的影響，減緩溫室氣體效應已成為全體應共同承擔的責任。

本公司溫室氣體排放量、用水量及廢棄物總重量統計如下：

1.近兩年溫室氣體排放量

年度	112 年度	113 年度
CO2 排放量 (公噸 CO2e)	155	146

說明：本公司主要耗能來自於外購電力、民生用電而造成間接之溫室氣體排放(範疇二)，將持續推動節能減碳政策，達成年度節電目標。

2.近兩年用水量

年度	112 年度	113 年度
用水量(度)	2,475	2,465

說明：廠內耗水多為生活用水，將持續向同仁宣導節水資訊，讓同仁意識水資源的可貴，進而節約用水。

3.近兩年廢棄物總重量

年度	112 年度	113 年度
廢棄物總重量(T)	2.576	3.398

說明：因員工人數增加，故生活垃圾量也隨著增加，將持續推動廢棄物減量管理(如：提供員工環保餐具、不提供一次性餐具)，建立員工減塑的生活習慣，深植綠色永續觀念，期能達成環境永續發展之低碳企業。

➢ 未來量化管理目標

節能減碳目標	因應氣候變遷，本公司將持續致力於節能減碳，以量化管理為方法，將以 113 年度為基準年，目標為 113 年到 115 年能再下降 2%之減碳量。
水資源控制目標	因應全球水資源短缺議題，將以 113 年度為基準年，目標為在 115 年前讓公司總用水量下降 1%，以具體行動與全球企業共同面對氣候變遷的挑戰。
廢棄物減量目標	持續推動廢棄物減量及分類管理，透過員工教育訓練佐以員工行為規範，以 113 年度為基準年，目標為 113 年到 115 年能再下降 1%之廢棄物總量。

註 2：

◆ 薪酬福利

本公司訂定及實施合理員工薪資及福利措施。員工薪資取決於學經歷、績效及市場行情，不因性別、種族、宗教、政治立場、婚姻狀況而有差別待遇。本公司遵循「勞動基準法」及相關法令訂定員工各項薪資福利措施，如休假、基本工資、退休等，以保障員工權益。本公司致力建置工作及生活平衡的職場氛圍，福利設計上提供全職員工完善且優於勞基法的福利規劃，如優於法令的給假福利、健康照護與急難救助、活絡化活動及特約福利、育兒措施及哺育環境、友善的工作環境等。

➢ 優於法令的給假福利

1.額外給予 7 天特定彈性假供同仁彈性運用。

2.為體恤同仁，配偶之父母、子女喪亡者，優於法令給予 64 小時給薪喪假之福利。

➢ 健康照護與急難救助

1.定期進行員工健康檢查，積極追蹤關懷員工健康。

2.設有員工協助方案、傷病處理關懷等機制，全方位守護員工健康。

3.提供急難救助金等，協助同仁急難情況救助。

➢ 活絡化活動及特約福利

1.設有福委會，舉辦年終晚會、國內旅遊、慶生會等活動。

2.設有員工社團，提供社團活動補助。

3.與全台各地店家簽訂企業特約，讓同仁在食、衣、住、行各面向皆能享受優惠。

➢ 育兒措施及哺育環境

1.鼓勵員工生育，結婚禮金、產假、產檢假、育嬰留停、集乳室、彈性調整工時等措施。

2.協助園區幼兒園、實驗中小學報名作業等，照顧同仁孩童教育需求。

➢ 友善的工作環境

1.員工餐廳、小型健身房

2.視障按摩師進駐。

更多福利詳細資訊請參閱本年報第 63~64 頁員工福利。

◆ 多元作為

金麗尊重每一位員工的獨特性，強調平等對待並提供友善的職場環境。在招募員工時重視工作權的平等，以每個職位所需的專業能力作為選才的優先考量，不因種族、國籍、性別、婚姻狀況、年齡、殘疾、家庭狀況、性取向、政治信仰等因素而有差別待遇。

◆ 績效導向的薪酬制度

本公司依據個人績效表現、職責承擔度及未來發展潛力，提供調薪、差異化獎金、員工酬勞制度及股票報酬(員工認股權憑證、庫藏股、限制員工權利新股及員工持股信託)，以期吸引、留任與激勵優秀的同仁。另外，本公司時常關注市場薪酬趨勢，以確保提供具市場競爭力之整體薪酬。本公司年度以當年度獲利狀況 8%至 30%分派員工酬勞，使全體員工得以共享經營成果，未來將充分結合永續指標並以實踐企業社會責任為目標，請參閱本年報第 40~41 頁員工及董事酬勞。

註 3：

◆ 員工人身安全與工作環境的保護措施與其實施情形

本公司重視每一位員工，為提供員工安全的工作環境及友善健康的職場，並能安心的工作，持續推動職業安全衛生相關之教育訓練及宣導，並建立安全衛生內部管理政策，定期採取監控措施，提早發現公司高風險事項，並採取改善措施，以達到合法合規及保護員工安全及健康之目的。

➢ 本公司 113 年度環安衛管理成果重點如下：

目標	具體措施說明	執行狀況
飲用水檢測	為維護員工飲用水品質及健康，依「飲用水連續供水固定設備使用及維護管理辦法」，每季委託環境部許可機構進行飲水機之大腸桿菌群抽樣檢測。	檢測全公司飲水機:每季檢測。(113 年 3、6、9、12 月) 合格率:100%。
勞工作業環境監測	依「勞工作業環境監測實施辦法」每半年對工作場所之二氧化碳進行測定採樣，分析環境中化學物質濃度，以保護員工避免物理性及化學性傷害	執行作業環境監測:每半年一次 合格率:100%。 平均 CO2 濃度檢測: 113 年 1 月: 1374.9 ppm 113 年 7 月: 701 ppm 符合法規標準:5000ppm 以內
安全衛生查核及內部巡檢	每周於各廠區進行安全衛生查核。	主動發現各廠區作業環境之潛在危害，提出改善方案，消除風險。
消防訓練/消防定檢	定期舉辦消防訓練，進行員工自衛消防編組、演練、應變、善後處理等步驟。 每季實施場內消防設備定檢，以預防火災並降低災害之影響。	當年度火災之件數 0 件、死傷人數 0。 消防訓練:每半年實施一次 (實施情形：113 年 5、12 月) 消防定檢:每季執行一次 (實施情形：113 年 3、6、9、12 月)
定期提供免費健康檢查及後續追蹤	每年度辦理至少一次全廠員工健檢，除檢驗項目優於法規並進行後續追蹤。於每年對所合作之醫療院所進行供應商評鑑，以確保健檢品質。	113 年 12 月委託台北榮民總醫院桃園分所臨場辦理全廠員工健康檢查並於當日安排醫生提供後續面談服務，包含危害預防評估、日常健康認知等。 113 年 8 月進行評鑑，評鑑結果為通過。

門禁安全	為確保員工在工作場所之安全，本公司設有門禁刷卡裝置及保全監視設備，以保障員工人身安全。	本公司各出入口皆設有門禁刷卡裝置，主要出入口亦有保全監視設備，以保障員工人身安全。
安全措施 （優於法規項目）	本公司注重員工健康福利，在公司內部設置緊急救護措施AED(Automated External Defibrillator)，稱為「自動體外心臟電擊去顫器」，可在意外發生時第一時間進行處理，進而預防憾事發生。 定期搭配員工教育訓練，讓同仁熟悉設備操作。	與立偉電子配合導入 AED 套裝整合服務，24H 遠端監測設備狀態及異常緊急連線通知。服務提供定期設備維護與異常檢測。

- 職業災害預防措施：

1.新進人員防災課程：

針對新進同仁進行人員的安全衛生防災課程，搭配專業人員說明，提升新進員工在工作上突發事件的應變能力。

2.意外事件及職業傷病追蹤：

意外事件非因當事人之故意、過失、不當作為或不作為所致之不可預見的事故或不幸。而身體的疾病與工作中的危險因子之間的因果關係，即有可能為職業傷病。職業傷病的「預防」很重要，為落實職業安全衛生管控，建立權責分工的執行組織，進一步強化職業傷害的預防，朝最佳健康職場的目標邁進。

3.職業災害事故通報機制：

依職業安全衛生法的相關規定，每月定期上網申報職業災害統計分析。即時掌握員工的職業災害狀況，定期宣導相關安全衛生事項，防止職災情形發生。

4.設備安全管理：

本公司針對危險性機械及設備均依法列管並建立自動檢查作業確保設備能安全操作。

- 自動檢查項目及頻率如下：

檢查項目	頻率
乾燥設備烘箱每年定期檢查	1 年/次
局部排氣裝置自動檢查	1 年/次
急救箱月檢	1 月/次
消防設備檢查及廣播測試	1 季/次

- 專業的工安管理人員：

持有專業證照的工安管理人員	人數
急救人員	1 人
防火管理人員	1 人
甲種勞工安全衛生業務主管	2 人

- 公司近三年工安績效-員工失能傷害統計

年度	死亡事故及重大失能事故	暫時全失能事故
111	男：0 ，女：0	男：0 ，女：0
112	男：0 ，女：0	男：0 ，女：0
113	男：0 ，女：0	男：0 ，女：0

說明：本公司 111 至 113 年全年度所有工作者皆無受傷失能案件，亦無職業病案例及無因公身故案例。針對零星之公司外發生之交通意外事故，透過定期發信向同仁進行宣導，以防止再度發生類似事故。

(六)上市上櫃公司氣候相關資訊：

1.氣候相關資訊執行情形

<table>
<tr><th>項目</th><th>執行情形</th></tr>
<tr><td>1.敘明董事會與管理階層對於氣候相關風險與機會之監督及治理。</td><td>本公司氣候治理最高單位為董事會，負責推動、決策公司之氣候相關策略方向，並監督公司整體氣候行動推展，董事會亦為決議公司氣候承諾與目標之關鍵角色。2024 年本公司成立永續資訊編制小組，由總經理擔任小組之召集人，總經理室為專責單位，負責永續資訊管理政策或相關管理方針。永續資訊編制小組針對公司之永續議題、包括氣候關鍵機會風險議題進行會議，且每年至少 4 次向董事會進行永續策略、包括氣候議題與其相關專案執行成效報告。永續資訊編制小組之職責為協助董事會決議之氣候風險管理政策、目標之落實，並將定期提交氣候風險因應規劃之執行成果。</td></tr>
<tr><td>2.敘明所辨識之氣候風險與機會如何影響企業之業務、策略及財務(短期、中期、長期)。</td><td>本公司定義氣候變遷風險與機會之時間範圍，短期為未來 3 年內、中期為未來 3-10 年、長期為未來 10 年以上。依據風險或機會對本公司的「發生可能性」及「衝擊程度」原則，永續資訊編制小組評估最攸關本公司的重大氣候風險與機會共 3 項，分別為 1 項轉型風險、1 實體風險與 1 項氣候機會，對公司之影響程度等因素，評估可能導致營業收入、營業成本等變動。</td></tr>
<tr><td>3.敘明極端氣候事件及轉型行動對財務之影響。</td><td>
<table>
<tr><th colspan="2">風險/機會</th><th>對公司的影響與衝擊</th><th>影響期程</th><th>財務影響</th><th>因應策略</th></tr>
<tr><td>轉型風險-市場</td><td>客戶行為改變</td><td>由於氣候變化或對氣候變遷意識的提高，客戶對產品和服務的偏好可能發生變化，導致採購政策的調整；此外，客戶可能會要求提供超越現有環保標準的產品和服務，或者對環保稽核提出更嚴格的要求。若無法滿足這些要求，本公司將失去部分市場佔有率。</td><td>短期</td><td>營收減少</td><td>●隨時注意最新的永續趨勢，並與客戶保持緊密聯繫，定期分析產業發展，擬定新技術及新產品的研發計畫，掌握客戶需求，減少營收下降的風險。
●導入綠色產品設計，包括降低功耗和縮小面積。
●分享研發成功經驗並協助客戶產品通過能效或其他相關規範標準。</td></tr>
</table>
</td></tr>
</table>

項目	執行情形					
	實體風險	平均溫度上升	隨著全球氣候變暖，平均氣溫上升導致用電需求持續增加，從而提升營運成本。此外，氣候變化可能引發供電不穩定，間接影響設備運行，甚至導致營運中斷。	中期	營運成本增加	●機房與實驗室皆有 UPS 不斷電系統，以避免供應不穩導致營運中斷的情形。 ●推動節能專案，減少源頭用電需求，辦公室換裝符合節能標章 LED 照明設備。 ●購置高效能空調設備，取代高耗能設備，以達到減少用電需求並可減少碳排放。
	機會	開發新產品和服務的研發與創新	透過創新和研發來應對氣候變化，除了保護環境有助於滿足現有客戶的期望外，且能開拓市場機會，增強品牌形象，吸引更多注重永續發展的客戶，為企業帶來更多的訂單和業績增長，進一步擴大產品的市場佔有率。	中期	營運成本增加、營收增加	●對全系列產品強化低能耗設計，提供更高效率省電的產品。 ●晶片朝微小化設計目標，同時搭配先進製程，降低整體功耗。 ●研發強化晶片效能的封裝技術，達到低碳、減料目的，以導入低碳供應鏈。
4.敘明氣候風險之辨識、評估及管理流程如何整合於整體風險管理制度。	本公司的氣候風險機會辨識由永續資訊編制小組負責執行，依循 TCFD 架構辨識氣候變遷風險與機會，並蒐集產業趨勢、國內外標竿企業具有共通性之風險機會、營運當地法規等要求，聚焦關注當前產業的氣候變遷機會與風險議題，並評估對本公司可能造成的衝擊及財務影響。經與內部高層討論後決議，確認本公司的氣候風險 2 項與氣候機會 1 項。未來本公司的氣候相關風險將整合到整體風險管理流程，包括更新風險管理政策和程序、加強風險監測和報告機制等。					
5.若使用情境分析評估面對氣候變遷風險之韌性，應說明所使用之情境、參數、假設、分析因子及主要財務影響。	本公司尚未使用情境分析評估氣候變遷風險。					
6.若有因應管理氣候相關風險之轉型計畫，說明該計畫內容，及用於辨識及管理實體風險及轉型風險之指標與目標。	本公司尚未訂定轉型計畫。					
7.若使用內部碳定價作為規劃工具，應說明價格制定基礎。	本公司未使用內部碳定價。					

項目	執行情形
8.若有設定氣候相關目標，應說明所涵蓋之活動、溫室氣體排放範疇、規劃期程，每年達成進度等資訊；若使用碳抵換或再生能源憑證(RECs)以達成相關目標，應說明所抵換之減碳額度來源及數量或再生能源憑證(RECs)數量。	2025 年排放密集度(範疇一與範疇二排放/員工人數)較 2024 年下降 1%。
9.溫室氣體盤查及確信情形與減量目標、策略及具體行動計畫。	依金融監督管理委員會 2022 年 3 月發布之「上市櫃公司永續發展路徑圖」，本公司屬實收資本額 50 億以下之公司，需於 2026 年完成盤查，2028 年完成確信，本公司將依主管機關發布之參考指引及相關規定，持續控管溫室氣體盤查及查證揭露時程之完成情形。

(七)履行誠信經營情形及與上市上櫃公司誠信經營守則差異情形及原因：

評估項目	運作情形(註1)			與上市上櫃公司誠信經營守則差異情形及原因
	是	否	摘要說明	
一、訂定誠信經營政策及方案				
(一)公司是否制定經董事會通過之誠信經營政策，並於規章及對外文件中明示誠信經營之政策、作法，以及董事會與高階管理階層積極落實經營政策之承諾？	V		本公司雖未制定經董事會通過之誠信經營政策，然訂有「員工從業道德守則」，於內部規章、年報上揭露誠信經營政策，並由稽核室負責監督執行。	無重大差異。
(二)公司是否建立不誠信行為風險之評估機制，定期分析及評估營業範圍內具較高不誠信行為風險之營業活動，並據以訂定防範不誠信行為方案，且至少涵蓋「上市上櫃公司誠信經營守則」第七條第二項各款行為之防範措施？	V		本公司各項相關辦法與制度業已涵蓋防範不誠信行為方案，並對營業範圍內具較高不誠信行為風險之營業活動，執行多人覆核及定期執行稽核等控制措施，以防止收賄或其他不法弊端發生。	無重大差異。
(三)公司是否於防範不誠信行為方案內明定作業程序、行為指南、違規之懲戒及申訴制度，且落實執行，並定期檢討修正前揭方案？	V		本公司於「員工從業道德守則」中明確規範「禁止收受或給予供應商回扣或其他不正當利益」，同時制定「同仁廉潔守則」，以提升同仁誠信及自律觀念。	無重大差異。
二、落實誠信經營				
(一)公司是否評估往來對象之誠信紀錄，並於其與往來交易對象簽訂之契約中明定訂誠信行為條款？	V		本公司訂有「員工從業道德守則」，明確規範「禁止收受或給予供應商回扣或其他不正當利益」，以求最合理報價、最佳品質。	無重大差異。
(二)公司是否設置隸屬董事會之推動企業誠信經營專責單位，並定期(至少一年一次)向董事會報告其誠信經營政策與防範不誠信行為方案及監督執行情形？	V		本公司指派人力資源單位負責「員工從業道德守則」及「同仁廉潔守則」之修訂、執行、解釋、諮詢服務及通報作業，並由稽核室負責監督執行。	無重大差異。
(三) 公司是否制定防止利益衝突政策、提供適當陳述管道，並落實執行？	V		本公司「員工從業道德守則」明確要求，同仁執行業務時，如涉及本人或本公司的潛在利益衝突應向本公司人力資源單位提出報告。	無重大差異。
(四)公司是否為落實誠信經營已建立有效的會計制度、內部控制制度，並由內部稽核單位依不誠信行為風險之評估結果，擬訂相關稽核計畫，並據以定期查核防範不誠信行為方案之遵循情形，或	V		本公司已依各項法規訂定會計制度、內部控制制度，為確保落實，本公司內部稽核人員每年依風險評估結果對各項作業進行查核，並定期於董事會報告。	無重大差異。

評估項目	運作情形(註1)			與上市上櫃公司誠信經營守則差異情形及原因
	是	否	摘要說明	
委託會計師執行查核？ （五）公司是否定期舉辦誠信經營之內、外部之教育訓練？	V		本公司透過各項會議宣導企業誠信經營理念。	無重大差異。
三、公司檢舉制度之運作情形 （一）公司是否訂定具體檢舉及獎勵制度，並建立便利檢舉管道，及針對被檢舉對象指派適當之受理專責人員？ （二）公司是否訂定受理檢舉事項之調查標準作業程序、調查完成後應採取之後續措施及相關保密機制？ （三）公司是否採取保護檢舉人不因檢舉而遭受不當處置之措施？	V V V		請參閱「金麗科技股份有限公司公司內、外部人員對於不合法(包含貪污)與不道德行為的檢舉制度」https://www.rdc.com.tw/?route=esg/manage，該辦法中訂定具體檢舉及獎勵制度及受理檢舉事項之調查標準作業程序及相關保密機制，對檢舉人採取不對外公開之保密制度，保護檢舉人不因檢舉而遭受不當處置。	無重大差異。 無重大差異。 無重大差異。
四、加強資訊揭露 （一）公司是否於其網站及公開資訊觀測站，揭露其所定誠信經營守則內容及推動成效？	V		本公司設有網站，揭露相關企業文化、經營方針等資訊。	無重大差異。
五、公司如依據「上市上櫃公司誠信經營守則」定有本身之誠信經營守則者，請敘明其運作與所定守則之差異情形：無。				
六、其他有助於瞭解公司誠信經營運作情形之重要資訊：(如公司檢討修正其訂定之誠信經營守則等情形) 1.本公司遵守公司法、證券交易法、商業會計法、上市上櫃相關規章或其他商業行為有關法令，以作為落實誠信經營基本原則，並隨時注意誠信經營相關規範發展，據以檢討改進，提升本公司誠信經營成效。 2.本公司「董事會議事規範」中訂有董事利益迴避制度，對董事會所列議案，與其自身或其代表之法人有利害關係，致有害公司利益之虞者，得陳述意見及答詢，不得加入討論及表決，且討論及表決時應予迴避，並不得代理其他董事行使其表決權。 3.本公司訂有「內部重大資訊處理暨防範內線管理作業程序」，建立良好內部重大資訊處理及揭露機制，避免資訊不當揭露，並確保本公司對外界發表資訊之一致性與正確性。				

(八) 其他足以增進對公司治理運作情形之瞭解的重要資訊：公司業已制定「公司治理實務守則」及「內部重大資訊處理暨防範內線管理作業程序」。

(九) 內部控制制度執行狀況：

1.內部控制聲明書：請參閱公開資訊觀測站，公司治理>公司規章/內部控制>內控聲明書公告(https://mops.twse.com.tw/mops/#/web/t06sg20)。

2.委託會計師專案審查內部控制制度者，應揭露會計師審查報告：無。

(十) 最近年度及截至年報刊印日止，股東會及董事會之重要決議：請參閱第 78 頁至第 79 頁。

(十一) 最近年度及截至年報刊印日止董事或監察人對董事會通過重要決議有不同意見且有紀錄或書面聲明者，其主要內容：無。

(十二) 董事及監察人進修之情形：

職 稱	姓名	進修日期	主辦單位	課程名稱	進修時數	備註
董事長	易建男	113/09/11	財團法人中華民國證券暨期貨市場發展基金會	上市櫃公司永續發展策略與規劃	3	-
		113/10/04	社團法人中華公司治理協會	淨零碳排宣導會-台中場	3	-
董事	陳有諒	113/08/01	社團法人中華公司治理協會	ESG 與企業永續	3	-
		113/08/01	社團法人中華公司治理協會	從裁罰案例探討公司治理應加強之道-食安、環安篇	3	-
董事	呂理達	113/08/08	財團法人中華民國會計研究發展基金會	淨零碳排對財報影響實務解析	3	-
		113/10/18	財團法人中華民國證券暨期貨市場發展基金會	113 年度防範內線交易宣導會	3	-
董事	胡鈞陽	113/03/22	證交所	CDP 台灣發表會-以永續知識力打造全新碳時代宣導會	3	-
		113/05/24	社團法人中華民國工商協進會	非常規交易犯罪行為研析	3	-
董事	詹顯德	113/11/13	財團法人中華民國證券暨期貨市場發展基金會	永續發展路徑的挑戰與機會及溫室氣體盤查介紹	3	-
		113/11/13	財團法人中華民國證券暨期貨市場發展基金會	審計委員會之運作實務	3	-
獨立董事	林進財	113/10/28	財團法人台北金融研究發展基金會	生成式 AI 產業發展趨勢	3	-
		113/10/29	社團法人台灣專案管理學會	數位轉型與最新資訊科技	3	-
獨立董事	張世穎	113/11/29	財團法人中華民國證券暨期貨市場發展基金會	矽光子定義網路：矽光子(SiPh)與共同封裝光學(CPO)的發展趨勢	3	-
		113/12/05	財團法人中華民國證券暨期貨市場發展基金會	碳權交易機制與碳管理應用	3	-
獨立董事	張郁禮	113/09/04	財團法人中華民國證券暨期貨市場發展基金會	非財會背景董監事如何審查財務報告	3	-
		113/09/05	財團法人中華民國證券暨期貨市場發展基金會	2024 下半年營運展望-最新台灣產業經理人(PMI/NMI)現況、策略與挑戰	3	-
獨立董事	蕭錫錬	113/10/28	財團法人台北金融研究發展基金會	生成式 AI 產業發展趨勢	3	-
		113/11/04	財團法人台北金融研究發展基金會	國際貿易洗錢防範與經濟制裁案例	3	-

(十三) 本公司經理人對公司治理相關進修情形：

職 稱	姓名	進修日期	主辦單位	課程名稱	進修時數	備註
總經理兼執行長	易建男	113/09/11	財團法人中華民國證券暨期貨市場發展基金會	上市櫃公司永續發展策略與規劃	3	-
		113/10/04	社團法人中華公司治理協會	淨零碳排宣導會-台中場	3	-
財務處處長	呂世民	113/09/12~113/09/13	財團法人中華民國會計研究發展基金會	發行人證券商證券交易所會計主管持續進修班	12	-
公司治理主管	陳沼惠	113/09/11	證券櫃檯買賣中心	上櫃興櫃公司內部人股權宣導說明會 新竹場	3	-
		113/09/19	台灣科學園區科學工業同業公會	企業內部人違法「內線交易」之法律責任與案例解析	3	-
		113/10/08	證券櫃檯買賣中心	2024WIW：AI 熱潮下的數位金融及永續金融協奏曲專題講座	3	-
		113/11/21	台灣科學園區科學工業同業公會	「虛偽交易」與「財報不實」之法律責任與案例解析	3	-

三、簽證會計師公費資訊：

金額單位：新臺幣千元

會計師事務所名 稱	會計師姓 名	會計師查核期間	審計公費	非審計公費	合計	備註
資誠聯合會計師事務所	劉倩瑜 謝智政	113/1/1~113/12/31	1,930	880	2,810	註

註：非審計公費服務內容主係稅務簽證、財務及稅務等顧問諮詢服務。

(一)更換會計師事務所且更換年度所給付之審計公費較更換前一年度之審計公費減少者，應揭露更換前後審計公費金額及原因：不適用。

(二)審計公費較前一年度減少達百分之十以上者，應揭露審計公費減少金額、比例及原因：不適用。

四、更換會計師資訊：無。

五、公司之董事長、總經理、負責財務或會計事務之經理人，最近一年內曾任職於簽證會計師所屬事務所或其關係企業者：無。

六、最近年度及截至年報刊印日止董事、監察人、經理人及持股比例超過百分之十之股東股權移轉及股權質押變動情形：

單位：股

職稱	姓名	113年度		114年截至4月30日止	
		持有股數增(減)數	質押股數增(減)數	持有股數增(減)數	質押股數增(減)數
董事長暨總經理	易建男	0	0	0	0
董事	陳有諒	0	0	0	0
董事	呂理達	0	0	0	0
董事	胡鈞陽	0	0	0	0
董事	詹顯德	0	0	0	0
獨立董事	林進財	0	0	0	0
獨立董事	張世穎	0	0	0	0
獨立董事	張郁禮	0	0	0	0
獨立董事	蕭錫錬	0	0	0	0
財務處處長	呂世民	0	0	0	0
公司治理主管	陳沼惠	0	0	0	0

(一) 股權移轉予關係人資訊：無。

(二) 股權質押予關係人資訊：無。

七、持股比例占前十名之股東，其相互間為關係人或為配偶、二親等以內之親屬關係之資訊：

姓名（註1）	本人持有股份		配偶、未成年子女持有股份		利用他人名義合計持有股份		前十大股東相互間具關係人或為配偶、二親等以內之親屬關係者，其名稱或姓名及關係		備註
	股數	持股比率(%)	股數	持股比率	股數	持股比率	名稱	關係	
易建男	3,399,602	4.84%	—	—	—	—	—	—	—
花旗託管挪威中央銀行投資專戶	2,506,750	3.57%	—	—	—	—	—	—	—
吳錦儒	2,019,270	2.87%	—	—	—	—	—	—	—
陳有諒	1,895,517	2.70%	—	—	—	—	—	—	—
呂理達	1,338,061	1.90%	—	—	—	—	—	—	—
胡鈞陽	1,293,285	1.84%	15,732	0.02%	—	—	—	—	—
詹顯德	1,030,000	1.47%	—	—	—	—	—	—	—
匯豐銀行託管摩根士丹利國際有限公司專戶	738,998	1.05%	—	—	—	—	—	—	—
呂世民	536,482	0.76%	34,202	0.05%	—	—	—	—	—
張碧雪	496,510	0.71%	—	—	—	—	—	—	—

註1：應將前十名股東全部列示，屬法人股東者應將法人股東名稱及代表人姓名分別列示。
註2：持股比例之計算係指分別以自己名義、配偶、未成年子女或利用他人名義計算持股比率。
註3：將前揭所列示之股東包括法人及自然人，應揭露彼此間之關係。

八、公司、公司之董事、監察人、經理人及公司直接或間接控制之事業對同一轉投資事業之持股數，並合併計算綜合持股比例：無。

參、 募資情形

一、資本及股份

(一) 股本來源

年月	發行價格	核定股本		實收股本		備註		
		股數(仟股)	金額(仟元)	股數(仟股)	金額(仟元)	股本來源	以現金以外之財產抵充股款者	其他
86.08	10	500	5,000	500	5,000	募集設立	無	投建商營字第04106700號
87.12	10	18,000	180,000	8,500	85,000	現金增資	無	87建三戊字第285755號
89.01	25	24,000	240,000	19,500	195,000	現金增資	無	經商字第088147255號
90.05	25	24,000	240,000	24,000	240,000	現金增資	無	經商字第09001177550號
91.09	10	48,000	480,000	30,000	300,000	資本公積轉增資	無	園商字第0910023961號
93.08	10	48,000	480,000	34,200	342,000	註 1	無	園商字第0930022497號
94.03	19	48,000	480,000	38,100	381,000	現金增資	無	園商字第0940005623號
94.09	10	48,000	480,000	42,056	420,560	註 1&註 2	無	園商字第0940026141號
94.12	10	48,000	480,000	42,183	421,830	註 2	無	園商字第0940035913號
95.07	10	48,000	480,000	42,382	423,820	註 2	無	園商字第0950016039號
95.10	10	48,000	480,000	42,516	425,160	註 2	無	園商字第0950026666號
96.01	10	48,000	480,000	42,762	427,620	註 2	無	園商字第0960000227號
96.04	10	48,000	480,000	42,900	429,000	註 2	無	園商字第0960008278號
96.07	10	48,000	480,000	43,199	431,990	註 2	無	園商字第0960017596號
96.09	10	68,000	680,000	48,074.7	480,747	註 1&註 2	無	園商字第0960024758號
97.01	10	68,000	680,000	48,150.7	481,507	註 2	無	園商字第0960035764號
97.04	10	68,000	680,000	48,366.7	483,667	註 2	無	園商字第0970008812號
97.07	10	68,000	680,000	48,426.7	484,267	註 2	無	園商字第0970019108號
97.10	10	68,000	680,000	56,430.7	564,307	註 1&註 2	無	園商字第0970028695號
98.01	10	68,000	680,000	56,607.7	566,077	註 2	無	園商字第0980001374號
98.04	10	68,000	680,000	56,742.7	567,427	註 2	無	園商字第0980009022號
98.07	10	68,000	680,000	56,748.7	567,487	註 2	無	園商字第0980019741號
98.09	10	68,000	680,000	56,768.7	567,687	註 2	無	園商字第0980025319號
99.01	10	68,000	680,000	56,772.2	567,722	註 2	無	園商字第0990000234號
99.04	10	90,000	900,000	58,852.2	588,522	私募增資	無	園商字第0990012110號
99.09	10	90,000	900,000	58,923.7	589,237	註 2	無	園商字第 0990026841 號
99.12	10	90,000	900,000	59,100.7	591,007	註 2	無	園商字第 0990039108 號
100.04	10	90,000	900,000	59,101.7	591,017	註 2	無	園商字第 1000009810 號
101.11	10	90,000	900,000	60,501.7	605,017	私募增資	無	園商字第 1010033829 號
103.03	10	90,000	900,000	61,431.7	614,317	私募增資	無	竹商字第 1030009456 號
103.10	10	90,000	900,000	61,652.7	616,527	註 2	無	竹商字第 1030029934 號
104.03	10	90,000	900,000	62,276.7	622,767	私募增資	無	竹商字第 1040005718 號
104.04	10	90,000	900,000	62,303.7	623,037	註 2	無	竹商字第 1040010041 號
104.08	10	90,000	900,000	62,587.7	627,587	註 2/註 3	無	竹商字第 1040023637 號

年月	發行價格	核定股本		實收股本		備註		
		股數(仟股)	金額(仟元)	股數(仟股)	金額(仟元)	股本來源	以現金以外之財產抵充股款者	其他
104.10	10	90,000	900,000	62,792.7	627,927	註 2	無	竹商字第 1040030676 號
106.04	10	90,000	900,000	67,792.7	677,927	現金增資	無	竹商字第 1060008534 號
111.06	10	120,000	1,200,000	67,792.7	677,927	-	無	竹商字第 1110020692 號
112.08	10	120,000	1,200,000	69,826.5	698,265	註 4	無	竹商字第 1120028799 號
113.11	10	120,000	1,200,000	70,306.5	703,065	私募增資	無	竹商字第 1130037224 號

註1：員工分紅暨盈餘轉增資
註2：員工認股權轉換增資
註3：限制員工權利新股轉換增資
註4：盈餘轉增資

單位：股

股份種類	核定股本			備註
	流通在外股份	未發行股份	合計	
記名式普通股	70,306,495	49,693,505	120,000,000	上櫃公司股票

總括申報制度相關資訊：無。

(二) 主要股東名單

114 年 4 月 19 日；單位：股

主要股東名稱 / 股份	持有股數	持股比例%
易建男	3,399,602	4.84%
花旗託管挪威中央銀行投資專戶	2,506,750	3.57%
吳錦儒	2,019,270	2.87%
陳有諒	1,895,517	2.70%
呂理達	1,338,061	1.90%
胡鈞陽	1,293,285	1.84%
詹顯德	1,030,000	1.47%
匯豐銀行託管摩根士丹利國際有限公司專戶	738,998	1.05%
呂世民	536,482	0.76%
張碧雪	496,510	0.71%

(三) 公司股利政策及執行狀況

1.公司股利政策

本公司分派每一會計年度盈餘，除依法繳納營利事業所得稅外，應先彌補歷年虧損，所餘盈餘應提出百分之十為法定盈餘公積；但法定盈餘公積已達本公司資本總額時，不在此限。另依相關法令規定提列或迴轉特別盈餘公積後，併同期初未分配盈餘為股東累積可分配盈餘，由董事會擬定盈餘分配案提請股東會決議分派之。

本公司係屬營運成長階段之高科技事業，將考量公司所處環境及成長階段，

因應未來資金需求及長期財務規劃，及滿足股東對現金流入之需求，公司於年度決算後如有盈餘，每年分派之現金股利不低於當年度分派現金及股票股利合計數的百分之十；惟實際分派比率，仍依股東會決議之。

2.本年度擬(已)議股利分配情形

本公司 114 年 3 月 5 日董事會決議 113 年度虧損撥補案，113 年度稅後淨損新台幣 24,114 仟元，惟尚待股東會承認。

(四) 本次股東會擬議之無償配股對公司營業績效及每股盈餘之影響：無。

(五) 員工、董事及監察人酬勞：

1.公司章程所載員工分紅及董事、監察人酬勞之成數或範圍

公司應以當年度獲利狀況之百分之八至三十分派員工酬勞及應以不高於當年度獲利狀況之百分之三分派董事酬勞。但公司尚有累積虧損時，應予彌補。

員工酬勞得以股票或現金為之，且發給股票或現金之對象，得包括符合一定條件之從屬公司員工。

上述所稱之當年度獲利狀況係指當年度稅前利益扣除分派員工酬勞及董事酬勞前之利益。

員工酬勞及董事酬勞之分派應由董事會以董事三分之二以上之出席及出席董事過半數同意之決議行之，並報告股東會。

2.本期估列員工、董事及監察人酬勞金額之估列基礎、以股票分派之員工酬勞之股數計算基礎及實際分派金額若與估列數有差異時之會計處理：

本公司依據公司章程所定之成數為基礎估列。實際配發金額若與估列數有差異時，係以會計估計變動處理，列為次年度之損益調整數。

3.董事會通過分派酬勞情形：

(1)以現金或股票分派之員工酬勞及董事、監察人酬勞金額：

本公司 113 年度虧損撥補案業經 114 年 3 月 5 日董事會決議通過，因 113 年度稅後淨損新台幣 24,114 仟元，期末待彌補虧損為新台幣 144,667 仟元，未分派員工及董事酬勞。

(2)以股票分派之員工酬勞金額及占本期個體或個別財務報告稅後純益及員工酬勞總額合計數之比例：不適用。

4.前一年度員工、董事及監察人酬勞之實際分派情形(包括分派股數、金額及股價)、其與認列員工、董事及監察人酬勞有差異者並應敘明差異數、原因及處理情形：

本公司 113 年 6 月 13 日股東常會決議通過 112 年虧損撥補案，其員工、董事及監察人酬勞，與原董事會通過之擬議分派情形無差異。

(六) 公司買回本公司股份情形：無。

二、公司債辦理情形：無。

三、特別股辦理情形：無。

四、海外存託憑證之辦理情形：無。

五、員工認股權憑證辦理情形：無。

六、限制員工權利新股辦理情形：無。

七、併購或受讓他公司股份發行新股辦理情形：無。

八、資金運用計劃執行情形：詳見公開資訊觀測站>投資專區>私募專區>私募資料查詢(https://mops.twse.com.tw/mops/#/web/t116sb01)。

肆、 營運概況

一、業務內容

(一) 業務範圍

1.業務之主要內容：

(1)電子零組件製造業，研究、開發、製造及銷售下列產品：

A.16 位元及 32 位元微控制器。

B.微機電整合應用產品。

C.32 位元及 64 位元微處理器。

D.IA 自動化系統單晶片(SoC)產品。

E.數位系統應用產品。

F.伺服器暨雲端儲存系統晶片產品。

(2)有關前各項產品之進出口貿易業務。

2. 113 年度營業比重：

單位：%

產　　品	營業比重
微控制器半導體元件(晶片)	64.61
其　　他	35.39
合　　計	100.00

3.公司目前之商品(服務)項目：高效運算(HPC)處理器、微控制器(MCU：Microcontroller)、微處理器(MPU: Microprocessor)、網路處理器(Network Processor SoC) 、工業網通控制器(Industrial Networking Controller)、低功耗、多核心高效能之 x86 相容平台處理器，包括低耗電 IAD 連網平台、針對嵌入式應用或工業電腦所推出的 Emkore 平台，及客製化 IP 及 ASIC 等設計、製造及販賣。

4.計劃開發之新商品(服務)：多核心高效能運算晶片開發，可採用 12nm(含)以下之先進製程，提供高整合度及低耗電的優點；若對功耗沒有嚴格的要求下，亦可採用成熟製程並搭配公司自行開發的動態電路，可用較低的成本取得與媲美高階製程之性能，以上兩者皆可搭配多晶片封裝技術，彈性且多元應用於大數據資料運算及分析；64 位元高校運算處理器。以上開發可協助客戶於開發時程、效能及成本考量上取得最佳方案，有效應用於各類需求，包括工業控制、工業自動化及 x86-PC 單晶片的應用產品，如多軸馬達控制、工業機器手臂、高階可編程自動化控制器(PAC)、嵌入式智慧型裝置等目前公司相關業務，更可開創新的應用擴展新業務。

(二) 產業概況

1.產業之現況與發展

(1)IC設計及半導體產業之市場概況

據世界半導體貿易統計組織(WSTS) 2024 年 12 月發布的半導體市場預測報告，公布全球半導體市場 2024 年與 2025 年預估內容，2024 年全球半導體市場年成長幅度較前一年成長 16%、達 6,270 億美元；展望 2025 年，全球半導體市場將持續成長，預計成長 12.5%，估值達到 6,970 億美元，主要受記憶體與邏輯產業推動，WSTS 預測，2025 年半導體市場將廣泛成長，增幅為 11.2%，預計這兩個行業的價值將超過 4,000 億美元。

另一家市調機構 IDC 同樣預估 2025 年將迎來嶄新榮景。IDC 分析 2025 年全球半導體銷售市場年增率達 15%，全球人工智慧(AI)與高效能運算(HPC)需求持續攀升，從雲端資料中心、終端裝置到特定產業類別，各個主要應用市場均面臨規格升級趨勢。

區域市場方面，WSTS 預估美國、歐洲、日本及亞太區半導體市場在 2025 年將可持續成長，按地區劃分，美洲地區預計成長最快，達 15.4%，規模達到 2,153.1 億美元，其次是亞太地區，可能成長 10.4%，規模達到 3,762.7 億美元。日本市場預計成長 9.4%，達到 518.7 億美元(約新台幣 1.7 兆元)；歐洲預計增幅最小，為 3.3%，成長至 537.4 億美元。

產品別方面，2024 年的成長將主要由兩個半導體領域推動：記憶體預計成長 81.0%，邏輯預計成長 16.9%。兩領域皆較先前預測(邏輯成長 10.7%，記憶體成長 76.8%)上修。相反，分立元件、光電子元件、感測器和類比半導體等維持衰退預測。

日經(Nikkei)評論，2025 年全球半導體市場和人工智慧(AI)發展有緊密關係，來自生成式 AI 用數據中心的需求持續增長，邊緣運算需求將進一步推升，而純電動車(EV)和智慧手機的需求則近於停滯狀態。

工研院產科國際所預估，台灣 2024 全年半導體產業產值可望突破新台幣 5.3 兆元，年成長率達 22%。在 AI 和 HPC 等應用需求的推動下，2025 年臺灣半導體產業產值將突破新臺幣 6 兆元，預估年成長率為 16.5%；若從臺灣 IC 設計業、製造業、封測業等三大次產業來看，2025 年均有兩位數成長，持續推動臺灣 IC 產業向上發展。

因先進製程技術突破與挑戰門檻持續增高，以至於生產製造成本愈加昂貴，加上高階晶片異質整合需求，小晶片 Chiplet 已是未來高階晶片之重要發展趨勢。小晶片設計模式能降整體晶片成本，提高設計業晶片產品之競爭力：

近年來先進製程成本快速上升，因此設計業客戶先以先進製程晶片分割之設計方式，再用先進封裝整合之小晶片模式生產高階晶片，達到提高先進製程晶片之良率及降低生產成本之目的。

小晶片需先進封裝技術進行前後段同/異質整合，提高晶片效能。小晶片技術目前大多應用於雲端、伺服器及 AI 等先進製程晶片為主，需搭配先進封裝技術進行整合，目前大多採用 2.5D/3D-IC 技術，以求整合後效能不能比原先大晶片 SoC 差太多。台積電以先進製程搭配先進封裝技術，一條龍服務其先進製程晶片客戶，如 AMD、NVIDIA、Google 等。

先進製程遇微縮瓶頸，先進製程廠商數量逐漸遞減，晶片成本亦面臨瓶頸。先進封測因而崛起，特別是能增加單位面積電晶體數量的 2.5D/3D 堆疊技術。以晶圓廠為主，封測廠為輔，共同佈局 2.5D/3D 晶片堆疊技術。

封測廠主要佈局 UHD FO(超高密度扇出型封裝)及 2.5D 矽中介層技術，晶圓廠/IDM 為了延續摩爾定律，朝向 2.5D、後段 3D 及前段 3D 技術研發。

預估 2024 年全球專業封測代工產值達 405 億美元，年成長 9.0%，臺灣 IC 封測產業產值達新臺幣 6,275 億元，年成長 7.5%。 先進製程遇微縮逐漸遇到瓶頸，小晶片模式協同 2.5D/3D 晶片整合技術，共同合作延續甚至超越摩爾定律。 傳統旺季效應與邊緣 AI 需求的增長成為主要推動力，先進封裝與高效能運算相關需求持續攀升，帶動整體產業表現。

半導體應用市場推動臺灣 IC 設計業持續向上成長，2024 年臺灣 IC 設計業年產值 1.3 兆元，年增 16%，2025 年臺灣 IC 設計業年產值預測可達 1.42 兆元，年成長 11.3%。

(2)工具機之產業概況

工研院產科國際所分析預估全球工具機消費額與產值，2025 年全球產值預估為 870 億美元，較 2024 年成長 5.0%。TrendForce 報告指出，全球工具機市場因受疫情影響而衰退，然而由於全球經濟緩步復甦、終端應用市場隨之擴大，使得製造業生產需求仍在，預估全球工具機市場規模將持續 5%年增率成長，直至 2026 年達到 1,059.6 億美元。

台灣工具機公會(TMBA)表示，工具機產業產值 2025 年應該與 2024 年差不多，預計可能會持平或有一些小幅度的成長。展望 2025 年，則是持續受到全球地緣政治干擾、俄烏戰爭、通膨和減碳等因素，各國起落將影響工具機產業訂單前景，推測市場景氣會在 2025 下半年逐漸明朗。不過台灣向來是製造重鎮，且各行業別在經濟逆風中此消彼長，台灣仍有機會，目前台灣持續穩坐全球第五大出口國，公會預估 2025 年大環境不確定性因素面相多，但仍

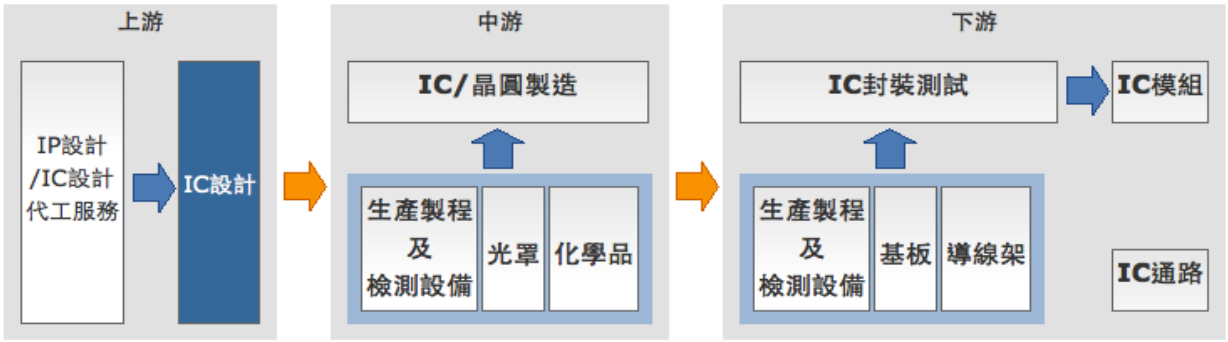
能與 2024 年持平或小幅成長。

2.產業上、中、下游之關聯性

IC 設計業原處於半導體產業體系中最前端之部份，並無上游關係，而其中下游產業依次為晶圓代工及晶圓製造、構裝及測試等。我國 IC 產業有別於國外大廠從設計、製造、構裝、測試垂直整合之架構，而是在每一生產環節皆有個別廠商投入且各有所專，形成一水平分工體系。

IC 設計公司主要業務為自行設計產品銷售或接受客戶之委託設計，屬腦力密集產業，其所需資本遠小於晶圓製造廠，且投資報酬率高，加上國內具備相當完善之半導體產業支援架構及 IC 設計人才日益充沛，進而促使不少廠商、投資者紛紛投入此一行業。IC 設計業在產業價值鏈中，屬於上游產業，完成最終產品前，必須經過專業晶圓代工廠或 IDM 廠(整合型半導體廠：Integrated Device Manufacturer，從設計、製造、封裝、測試到銷售都一手包辦)製作成晶圓半成品，再經由前段測試，然後轉給專業封裝廠進行切割及封裝，最後由專業測試廠做後段測試，測試後之成品則經由銷售管道售予系統廠商裝配生產成為系統產品。

茲將 IC 設計產業上、中、下游產業關聯圖列示如下：



資料來源：證券櫃檯買賣中心，半導體產業鏈簡介

3.產品發展趨勢

隨著工業 4.0、智能物聯網、大數據資料分析及 AI 不斷的擴大應用範圍，使得嵌入式處理器、工業自動化微控制器及高效能運算的需求持續向上攀升。客戶對供應商的需求不再只是更高技術整合創新產品而已，同時希望供應商能提供完整平台設計方案。如工業自動化應用強調的是即時控制及監控工廠內的自動化設備，其中包含馬達控制、機械手臂等。為切入市場，身為晶片設計服務廠商除了技術整合創新之外，不再只是單純的提供晶片而已，更需協助客戶打造更穩定和縮短開發上市時間的自動化應用。滿足客戶對性價比、高整合、低耗電及其對所擁有的智產權(know-how)的保護，或更進一步提供客製化的整體設計服務流程，像是提供 PCB 製作相關注意事項、BIOS/驅動程式/軟體參考程式及如何通過環境測試的設計規範等。而在高效能運算應用上不只著重 CPU 的效能與傳輸數據的

I/O，還需同時考量記憶體、GPU、I/O 傳輸、演算法等全面性軟硬體架構的平衡發展，才足以符合客戶的使用需求。公司貫徹以下方針來達到上述客戶的需求：

(1)客製化晶片服務，長期供貨保證

工業控制技術發展日趨複雜以及 PC 技術提升，近年來在 PC-based(以 PC 為硬體平台)控制器發展更為蓬勃，歐美領導自動化方案廠商更紛紛推出中高階種，主要滿足產線複雜化，資料蒐集、資訊整合、即時生產監控視覺化以及整合人機介面提供可視化資訊等較複雜的控制工作。其發展趨勢將自我診斷的相關智慧功能加入，讓控制技術須規劃更多複雜控制應用，這些發展趨勢實現在 PC-based 控制器可發揮分散式的架構及 PC-based 整合性較高的架構優點。本公司晶片為 PC 指令集相容架構，無論在人機介面控制器、數位控制器、可編程邏輯控制器或是整合人機介面之可編程邏輯控制器等應用，提供應用客戶端快速導入的最佳硬體平台，免除客戶負擔高轉換成本。

工業控制和嵌入式應用市場的特性為少量多樣，認證時期長。且近年已有越來越多系統廠商投入此市場，產品區隔及差異化即相當重要。本公司擁有自有核心技術及完整的周邊 IP，可依據客戶需求，提供高度客製化晶片方案，與其他採用一般標準晶片之競爭產品作區隔。此類專屬晶片模式，客戶一旦採用後就不易更換；相對地，本公司也提供長期供貨保證，確保工業客戶產品擁有十年甚至更久產品週期。藉由此類合作模式，與客戶發展互信共存關係。

(2)整合功能元件、提供標準介面，使客戶產品符合多樣化需求

雖然隨著半導體製程技術日益成熟，再加上輕薄短小產品以及降低成本等因素驅使下，傳統單一用途的 IC 已無法因應市場需求，IC 已朝多功能、高效能以及高穩定度的方向發展。但是將所有功能整合於單一晶片中，仍然有技術及價格的困難；因此，將主要功能整合於單一晶片中，並保有標準界面，如 USB、PCI-E 等，以便讓系統有更好的擴充性及多樣化，並提供高速傳輸介面及開放式匯流排讓客戶自有的 IP 能夠快速整合於設計中，除縮短產品開發時程外，也能滿足高效能運算應用的多樣性及可變性。如此也能讓客戶能在相同的平台中展現其附加價值，在不同的市場區隔中有其定位。除此之外，公司也在相關的封裝上做多方的研究及評估，將單晶片的概念也能藉由封裝的方式來達成。另外，在價格及維持客戶之間的的差異性以及協助客戶 Time-to-Market 都有非常好的成效。

(3)製程、IP及架構，創造新利基市場

公司除了藉由不斷提昇本身的研發技術能力，大約以兩年為一個進程，在

每個進程透過架構的改進，除小晶片架構的高速 I/O 介面已見成效，並進行動態電路開發，利用製程的優點將性能提昇至少 30%，有效降低耗電量提昇性價比。另外，公司也積極掌握關鍵 IP 並配合客戶的需求開發，符合客戶特殊應用的需求，注意市場動向，爭取新產品研發時效，創造新的利基市場。

(4)晶片廠商提供解決方案及整合平台

縮短系統開發廠商的上市時程，就等同是縮短自家 IC 的上市時程。早期 IC 設計公司皆站在協助的立場來幫忙系統廠，常常是曠日廢時。目前則朝向由 IC 設計公司提供方案及平台，與全球領導廠商合作雙贏解決方案，提供符合自動化應用產品組合，以縮短系統廠產品上市時程，更有助於市場之良性發展。因此公司不再只單純提供給客戶晶片，更一步要提供硬體技術支援及環境測試的設計規範以快速通過認證等，並以協助客戶成功不與客戶競爭、與客戶共榮共存為最高指導原則。

(5)市場及推廣

大陸工控機市場仍以自有品牌、台灣品牌、歐美品牌三分天下的局面。其中，大陸當地品牌因為價格便宜，服務便捷，受到了眾多客戶的歡迎；台灣品牌由於進入中國大陸市場較早，產品得到了較為廣泛的應用，擁有一批固定的用戶群體。

在品質優良且穩定的基礎下，在歷經多年的耕耘，公司業已持續並穩定供貨予許多工業控制/嵌入式系統廠商。客戶群涵括了台灣、大陸工業控制領域的知名品牌商；透過與這些系統客戶的合作，內建本公司所開發晶片之系統持續銷往歐美及大陸，公司將持續深耕並積極拓展應用及市場。

高效能運算應用上，除了在核心技術 x86 CPU 藉由架構或製程來提升效能外，配合的周邊 IP、高速傳輸介面、開放式匯流排等在取得良好的研發成果及專利後亦將持續開發，以保持產品的組合彈性及競爭力並擴大應用範圍。已陸續有客戶委由公司投入相關產品開發並展現在營收上。

4.競爭情形

以 x86 的系統平台來說，目前主要競爭者為，Intel、AMD 等公司。不過，在價格上，這些公司單就 CPU 及晶片組報價仍舊偏高，且其系統平台的製造門檻及成本也高，以致於系統的單機成本遲遲無法有效的降低。本公司在 x86 (包括 32 及 16 位元) CPU 產品上已銷售多年，並且不斷的精進並開發整合北橋、GPU、DSP 及除標準介面之周邊外，也持續開發工控/嵌入式應用及高效能運算所需之 IP，包括小晶片架構所需的高速 I/O 介面、動態電路等，以滿足客戶的相關需求。

除此之外，公司更緊密的與客戶合作，提供客戶參考電路、開發設計準則、驅動程式以及如何通過環境測試的設計指南等相關資料。而對於 ARM-Based 或 RISC-V 方案，以公司不斷於自主開發的 x86 架構上優化的成果，若論耗電量已在伯仲之間，但相對在性能及對作業平台的支援則遠勝於。公司目前亦開始進行 64 位元架構開發，未來更將提供符合客戶對高階產品的規劃需求。為符合客戶需求及擴大未來市場應用層面，若有客戶已有以 ARM 或 RISC-V 為核心的 IP，公司將持續提供開放匯流排連結並完成客製化晶片，保有客戶先前的研發投資。保持優勢並考量客戶利益保有最大彈性。

(三) 技術及研發概況

1.最近年度及截至年報刊印日止投入之研發費用

單位：新台幣仟元

項目	113 年度	114 年度 截至前一季止
投入之研發費用	246,757	60,837
營業收入淨額	424,695	75,212
研發費用佔營收淨額比例	58.10%	80.89%

2.最近年度及截至年報刊印日止開發成功之技術或產品

年度	研發成果
113	22nm 4核x86 SoC內建Dynamic Circuit線路設計的開發量產。 22nm 128核x86 Chiplet SoC的架構開發。 Fin FET先進製程PCIe Switch的設計開發。
114	22nm 4核x86 SoC的開發量產。 FinFET多核Out of order x86 Chiplet SoC架構開發。 FinFET先進製程PCIe Switch Fabric的設計開發。 高精度encoder的設計開發。

(四) 長、短期業務發展計劃

1.短期計劃

(1)行銷策略：

A.爭取與各主要嵌入式電子產品、工業電腦及工業控制/工業自動化廠商合作，推展 32 位元及 64 位元 MPU SoC 及 ASIC 市場。

B.擴展台灣、大陸及越南市場行銷通路，以開發潛在市場及客戶需求，其它地區則藉由與方案商、代理商合作，爭取更多業務。

(2)產品發展方向：

以 32/64 位元 x86 CPU 技術為主軸，整合自動控制及相關電腦周邊，開發工業電腦及工業控制完整的軟硬體解決方案,同時整合相關類比及介面電路，以利客戶在嵌入式產品單晶片 SoC 的需求。另外，搭配先進的封裝技術及串列式高速傳輸介面，可快速組合多樣產品因應不同市場的變化及需求。

(3)生產策略：

A.加強生產規劃及管理，以達準時交貨之需求。

B.加強與晶圓廠、封裝廠及測試廠等外包廠商之聯繫溝通，充分掌握各外包廠產能的變化，以機動調整產能負荷與產品庫存，以有效降低生產成本。

C.維持與外包廠良好互動機制，以有效掌握產品品質及生產進度。

(4)營運策略：

A.開發 32/64 位元 x86 SoC，聚焦於嵌入式、工業電腦及工業控制相關市場。

B.藉由多核 CPU 效能提昇並搭配先進的封裝技術及串列式高速傳輸介面，以滿足在 x86 工業自動化及高效能運算不同市場的需求。

(5)財務策略：

A.尋求策略伙伴投資，增加資金募集管道，健全財務結構。

B.以穩健的財務操作，使資金運用達到最大效益。

2.長期發展計劃

(1)行銷策略：

A.以亞太地區為行銷主軸，靈活運用自有及經銷體系之技術能力，提供產品設計服務，紮根各項產品之應用，提高產品投資報酬率。

B.建立全球行銷通路及銷售據點，強化市場分析，朝向國際化策略發展，以提升市場知名度及佔有率。

C.積極培養銷售人才，提升國際行銷能力並強化技術支援，爭取與世界級大廠銷售合作機會。

D.配合封裝技術，以最佳化研發投入及產品產出並符合市場需求，包括功能及時點。

(2)產品發展方向：

A.發展高整合低功耗 x86 SoC，以滿足手持式、工業控制市場的需求。

B.發展高性能低功耗多核 x86 平台解決方案,以滿足高效能運算應用的需求。

C.持續開發嵌入式市場及高效能運算應用所需的 IP，以提供市場高整合的單晶片 x86 SoC。

(3)生產策略：

A.與外包廠建立長期合作關係或策略聯盟，確保產能供應無虞。

B.尋求製程與產品間之最佳模式，以最低成本產出最佳產品功能。

C.持續良率提升作業以提高產品品質與降低生產成本。

(4)營運策略：

妥善運用並不斷投資精進自行研發之 x86 微處理器核心技術，透過整合工業控制、工業電腦、節能控制、高效能運算等應用領域所需之 IP 及技術，於各應用領域中推出具有高整合度之 SoC 產品及應用平台並透過與各應用領域內之領導廠商結為策略合作夥伴關係以達到快速建立全球技術及行銷體系、擴大營運規模，並共創雙贏之目標。

(5)財務策略：

配合公司經營規模，充分利用資本市場之各式理財工具，以取得較低廉營運資金，藉此強化財務結構。

二、市場及產銷概況

(一) 市場分析

1.主要商品之銷售地區

單位：新台幣仟元

年度 / 地區		112 年度		113 年度	
		金額	%	金額	%
內銷		194,709	64.52	175,178	41.25
外銷	亞洲	103,189	34.20	246,571	58.06
	美洲	1,826	0.60	-	-
	歐洲等地	2,053	0.68	2,946	0.69
	小計	107,068	35.48	249,517	58.75
合計		301,777	100.00	424,695	100.00

2.市場占有率

以公司的開發經驗並延續自主晶片核心架構的關鍵研發設計能力，針對目標應用市場例如嵌入式應用、工業控制、工業電腦及高效能運算。公司除在核心技術上掌握技術及專利外，在工業自動化市場也掌握關鍵元件技術及相關專利，並不斷累積產業經驗，推出的自有獨立設計的產業應用系統晶片，持續獲得國內工業電腦以及工業自動化領導廠商在技術以及品質方面認可及肯定。同時，並與全球領導廠商合作雙贏解決方案，以提昇本公司在產業供應鏈的長期優勢。

本公司產品策略不同于國外晶片大廠如 Intel 或是 AMD 採取是產品量大目標應用，本公司所採取的產品策略為發揮自有產品低功耗以及相對低的整體系統成本，在嵌入式市場應用開出利基市場並逐漸擴大於高效能運算應用，晶片出貨數在目標市場嵌入式應用以及工業控制應用皆保持著穩定出貨量，高效能運算應用上則已陸續完成重要的研發成果。工業控制市場特性是客戶導入後轉換成本很高，亦即客戶一但採用後就不容易更換，本公司擁有不易流失的客戶市場以及高產品毛利率。

工業自動化應用領域因設計導入時程較長，一般約需 2~3 年時間，目前在此領域的專案例如可程式化控制器、馬達驅動控制器、工具機數位控制器晶片、工業電腦單板模組主晶片、工業控制器主晶片、工業用平板電腦(panel PC) 、工業用無風扇強固式電腦(Fanless BOXPC)等專案，皆已量產上市。

本公司之產品在各應用上的市場占有率可如下表所示：

產品類別	市場佔有率
微控制器半導體元件(晶片)	～0.051%

*因產品屬性關係，IDC 等相關研究機構並未將 RDC 產品列入統計數字中。市佔率來自合理之評估。

3.市場未來之供需狀況與成長性

工業控制/嵌入式/工業電腦應用領域有下面幾項特性：(1) 以 x86 硬體架構作為開發系統軟體平台，累積軟體資源相當豐富，相關應用廣泛，系統相容性以及高可靠度為基本要求。(2) 應用廣泛以及生命週期長，客戶導入後轉換成本很高。(3) 因應工業 4.0 及智能物聯網應用的發展，長距離高速少接線硬體平台以及安全網路通訊傳輸是必然的趨勢。(4) 輕薄短小、低功耗、高效能不再只是消費性產品的特色，也是目前此產業所追求的。(5) 如何保護客戶在相關應用上的領域知識是供貨廠商應該要仔細思考的課題。工業電腦最早應用在工廠生產控制器或自動化設備中，近幾年來自動化設備有轉採用 PC 為平台架構，主要因為 PC 架構平台可以使控制系統的彈性增大，可以讓應用領域更廣，甚至應用至許多新應用領域或是市場，普及與人們日常生活的食、衣、住、行、育、樂方面，衍生的潛在商機龐大到無法量化。針對特定產業應用的工業電腦或是工業控制，因有軟體兼融性方面須考慮，系統轉換成本相對高，一旦決定系統架構後就不會輕易更改，故工業電腦或是嵌入式應用產品生命週期較一般消費性產品應用較長，而是至少 7 年以上的供貨保證，這是本公司投入資源在這目標市場所看重的穩定特性以及後續市場的成長潛力。

從長遠來看，工業控制/工業電腦/嵌入式市場仍將以穩定的速度發展，一方面，相關應用市場的產業規模擴大帶來更多需求，另一方面，其應用領域不斷擴展，新的應用點不斷出現，這些都是此產業發展的有利因素。其應用範疇除了傳統的工廠自動化控制，日常生活應用到的 POS/Kiosk、自動提款機、捷運讀票系統、數位電子看板等裝置，到進階的智能城市、智慧電網等多樣化的雲端智能物聯網相關發展應用，都是其成長的驅動力。於 2023 年疫情逐漸趨於緩和與進入後疫情時代，然而各方專家學者皆認為這波全球疫情大蔓延於未來將可能常態化，而為了因應常態化帶來的影響，將進一步帶動自動化設備與機器人的需求。TrendForce 預估全球智能製造市場規模在 2026 年將達到 6,200 億美元，GII 預計 2023 年至 2030 年的複合年增長率將以超過 13.5%穩定成長。

ARM 陣營確實有挾其在消費性產品的聲勢進軍工控領域，但是因無法完全滿足前述所提工控產業的特性，其對於軟體相容性、長期供貨以及客戶對於進入量產階段信心仍有待多方考驗及注意。反觀 x86 處理器平台除了在先天上便是工業控制產業的首選外，除了對軟體的相容性及對網路的完整支援，近年本公司更是朝向高整合度，並利用架構的改進及善用製程優點以達省電效益，未來將近一步搭配先進封裝技術，如 2.5D 封裝，除最佳化研發投入及產品產出外，在功能及市場需求時點上滿足客戶的需求。

高效能運算應用是公司重點開發的項目之一，不只著重 CPU 的效能與傳輸

數據的 I/O，透過加速零件、元件或整體模擬，有助運算密集、大量資料的應用程式，以符合客戶的使用需求。公司除持續投資於 x86 核心技術精進外，並開發必要的 IP，如串列式高速傳輸 I/O，開放匯流排的異質結合，另外善用先進封裝技術使產品更符合高效能運算應用的多變性。高效能運算晶片開發，可採用 12nm (含)以下之先進製程，提供高整合度及低耗電的優點；若對功耗沒有嚴格的要求下，亦可採用成熟製程並搭配公司自行開發的動態電路，可用較低的成本取得與媲美高階製程之性能，以上兩者皆可搭配多晶片封裝技術，彈性且多元應用於各種領域。

HPC 市場涵蓋對象包括，傳統將 HPC 用於模擬和建立模型的學術界，政府機構和企業客戶、應用於媒體和電子商務等運營的超大規模和公共雲業者，以及以金融服務、零售、電信和汽車產業為主的一般企業客戶等。這些業者或客戶目前都在應用某種形式的資料分析運算，或是如深度學習和機器學習等的 AI 運算。

據 Report Ocean，預計到 2027 年，全球 HPC 芯片組市場規模將從 2019 年的 43 億美元達到 136.8 億美元。

隨著全球 5G 佈建的腳步，5G 本身在佈建成本上的增加，也使得全球電信營運商進一步思考是否有降低佈建成本的解決方案。根據 ABI Research 分析 5G 基站成本支出顯示在固定成本佈建上，RAN 佔比約為 40%，而在基站租用成本上，也佔變動成本的 35%，在 2023 到 2025 期間大量部署採用 Open Ran 部署的 RAN 將成長 30~50%。全球 58%營運商認為 1 到 2 年後開放架構就會進入大規模部署，61%營運商表示 1 到 2 年內會以開放架構模式布建 5G。日本樂天 Open RAN 的整體架構以更高比例透過軟體虛擬化的模式進行彈性配置與整合管理，並將網路功能轉換為虛擬化軟體的形式運作後，此方式可以架構在通用型的 x86 硬體上運作。在硬體成本部分，除了採用 x86 硬體可大幅降低成本，讓單一用戶服務成本可降低以外，x86 伺服器也具備更容易配合需求進行擴充的特性，讓電信營運商在初期佈建時不需要預先以最高運算效能進行採購，而是可以依據用戶需求成長逐步採購。

善用 x86 處理器既有的優勢，再藉由新產品的開發及新應用的引進，期許公司於 2025 年度於市場佔有率及營業收入能持續增長。

4.競爭利基

(1)目標應用市場關鍵零組件提供者

本公司主要產品為工業控制和工業電腦中的關鍵零組件，應用廣泛以及生命週期長，客戶導入後轉換成本很高，亦即客戶一但採用後就不容易更換，擁

有不易流失的客戶市場。目前工業控制大廠如日系廠商和德系廠商，皆自主掌握其關鍵零組件。因此，本公司產品可幫助台灣工業產業提升關鍵技術，進而升級台灣工業產業鏈以及競爭力。另外，具有客製化能力是本公司的產品特色，藉由與客戶關鍵技術合作，開發出擁有世界級競爭力和差異化產品，為本公司開發自有技術延展的最大化表現。

工業控制技術發展日趨複雜以及 PC 技術提升，近年來在 PC-based(以 PC 為硬體平台)控制器發展更為蓬勃，歐美領導自動化方案廠商更紛紛推出中高階種，主要滿足產線複雜化，資料蒐集、資訊整合、即時生產監控視覺化以及整合人機介面提供可視化資訊等較複雜的控制工作。其發展趨勢將自我診斷的相關智慧功能加入，讓控制技術須規劃更多複雜控制應用，這些發展趨勢實現在 PC-based 控制器可發揮分散式的架構及 PC-based 整合性較高的架構優點。本公司晶片為 PC 指令集相容架構，無論在人機介面控制器、數位控制器、可編程邏輯控制器或是整合人機介面之可編程邏輯控制器等應用，提供應用客戶端快速導入的最佳硬體平台，免除客戶負擔高轉換成本。

此外，本公司自 86 年創立以來，研發團隊一直專注開發自有架構並相容 x86 指令集之處理器核心以及週邊相關技術，支援目前工業電腦使用主流的微軟作業系統。由於掌握核心架構技術，本公司更能致力於開發更卓越的設計以及邁向高階製程技術，持續發展電源使用效率更優異、運算效能更高的處理器核心，經過多年扎實研發實力累積，目前研發技術團隊已設計出多核心架構整合數位運算處理器於單一晶片，實為台灣半導體科技領域開創新的技術里程碑。

(2)提供系統平台的解決方案

本公司有鑑於工業控制和工業電腦之相關應用在硬體生產技術上有相對的技術門檻，技術銷售團隊不止於提供晶片方案，在幫助客戶縮短新產品上市時程目標下，提供給客戶為系統平台解決方案。除此之外，為了配合客戶的特殊應用需求並保護其在專業領域中的產業技術，本公司可依客戶需求提供專用 IC 晶片，解決客戶產品易被仿效問題，以關鍵核心技術方式保護客戶研發成果，持續保持產業競爭力；再者，為了降低客戶在系統上的開發成本，晶片在設計之初即以最終系統開發為出發點，讓客戶在使用本公司的解決方案之時，能用最簡單的方式，換言之，最低的成本、最快的時間來製造。因此，本公司雖為專業的IC設計公司，亦投注大量的資源及研發在系統設計和系統模擬上，主要目的是協助客戶成功而非與客戶競爭，與客戶共生共榮為最高指導原則。經過多年努力，在此方面以獲得客戶的肯定與支持；在設計時程的控制更為精準，有效節省開發成本、降低設計複雜度、增加設計效率以及加快產品上市時

程，提昇產品競爭力。本公司亦提供軟硬體開發環境於設計導入客戶，使新產品開發時程不斷縮短，並使產品線完整且具多樣性。

(3)產能與晶圓廠策略支持下不虞匱乏

對 IC 設計公司而言，晶圓代工廠的製程技術、品質良率、設備產能、交貨速度及價格為其產品開發競爭力及銷售成功與否的重要因素，而測試及封裝等協力廠的長期配合亦不可或缺。本公司在此方面有長期配合之供應廠商，故本公司除了能充分掌握晶圓代工來源並與協力廠商長期維持良好關係，使產出品質穩定且供貨不虞匱乏。

對於各晶圓廠先進製程的進度、IP 的種類及成熟的程度，在公司內部委有專人隨時注意並與晶圓廠取得聯繫，讓本公司的產品在品質、效能及價格上持續保有優勢。

(4)結合周邊 IC 廠商提供客戶完善產品開發服務

長久以來，除了 CPU 核心以外，台灣的 IC 設計產業在周邊零組件的設計能力，舉世聞名。不管在性能、價格，亦或供應鏈，都相當的完整。本公司所設計之 IC 就是應用於系統產品中的主要核心 CPU，為協助下游系統客戶縮短產品開發時程，本公司除以整體方案的服務方式提高客戶滿意度外，亦提供客戶產品開發所需之軟體、韌體以及應用程式庫等系統支援服務，並結合周邊 IC 廠商提供客戶完善產品開發服務，此服務有助於加速客戶產品設計時程，提升客戶之市場競爭力，並能與客戶共同成長及維繫長期良性的互動，更有助於帶動台灣整體的 IC 產業。除此之外，本公司也同時尋求跟世界 IC 設計大廠合作，將產品延伸至國際市場。

5.發展遠景之有利、不利因素與因應對策

(1)有利因素：

A.專業分工產業結構

台灣半導體工業採專業分工模式，IC 設計業者與半導體上游之晶圓代工、中下游之封裝、測試專業廠商形成專業且具備經濟規模之體系。公司在此一專業體系，提供迅速而有彈性之服務，並維持良好且穩定的合作關係，加上各大晶圓廠也都努力提升製程，在質與量均不斷提升下，使本公司得以充分掌握產能安排及新產品開發與上市之時效，此皆有助於本公司致力於提升產品優勢及產業競爭力。

B.優秀的經營團隊及研發能力

本公司高階省電 32 位元的微控制器以及微處理器等產品均擁有豐富的

研發及量產經驗，性能及相容性也深受客戶端的肯定，以豐富的平台解決方案經驗並掌握微控制器之核心技術，公司亦開始進行 64 位元架構開發，包括亂序執行(Out-of-Order)、多核芯多叢集高效緩存(Cache)處理架構等，無論在先進製程或是成熟製程，都能提供客戶最適方案，並可結合先進封裝技術，以滿足客戶對各階產品的規劃需求。目前應用系統亦漸趨要求多核心達到有效系統分工，本公司設計團隊業已設計開發出多核心、多芯片架構整合數位運算處理器的單一晶片，提供符合產業趨勢要求的晶片規格。另外，值得一提為本公司目前已擁有 SoC 架構所需之多項 IP 元件並取得各式專利，更以降低系統的製造門檻為 IC 設計的出發點，協助客戶有效降低設計複雜度及提高成本效益，縮短設計時程，達到 Time To Market 的要求，基於堅強之研發陣容加以對市場的靈活應變力，更有助因應市場快速變動及推出符合趨勢之產品。本公司也是目前國內首家專注於研發高階省電 32/64 位元 CPU 的 IC 設計公司。近年來，本公司除持續投資於 CPU 架構及效能研發外，更努力將自己提升為平台解決方案的提供者，提供給客戶更簡潔及快速的設計方案。

C.支援 x86 指令集之微處理器向工業控制/工業電腦/嵌入式/高效能運算應用之擴展

本公司之核心能力在於開發支援 x86 指令集之微處理器並且能依客戶及市場之需求針對不同之應用推出客製化之晶片。由於過去 x86 微處理器主要被應用在 PC 相關市場，其餘之應用市場則多為 ARM、MIPS 等非 x86 微處理器所佔據。不過，隨著國際大廠漸漸將注意力轉向個人電腦以外之其它商業應用市場並投入大量資源推動 x86 微處理器在諸如醫療、智能系統及 5G Open RAN 架構等市場之應用。以本公司之彈性及規模，將成為大廠進入非個人電腦應用市場後及市場擴大所帶來之額外商機之最大受益者之一。

(2)不利因素及因應對策

A.現存競爭者所擁有的優勢及少數系統廠的僵化思維

因應對策：

當今 x86 應用的主要提供者仍以美國大廠為主，但是其仍然無法完全貼近工控/嵌入式市場需要部分客製化的需求，並進而保護其在專業領域中的 Know-How，造成部分廠商仍停留在早期對 x86 的刻板印象，使得本公司在進入此市場必須投注更多的心力及時間來取的廠商的認同及信任。

本公司的產品設計之初即以客戶終端應用為出發點，無論在架構、耗能都有完善的考量，完全跟競爭者的市場作出不同的區隔，以便更貼近客戶需

求。產品設計更以平台的觀念，將系統製造門檻及成本降至最低，讓客戶更有競爭力。除此之外，更以產品的品質、提供長期供貨保證，並以保護客戶為最高指導原則，取得客戶的信賴而成為長期合作的夥伴。

B.市場變化迅速，競爭者眾，形成產品開發上的壓力

因應對策：

除了在 IC 的設計上採自行開發 IP，依產品功能與規格將基本必要的 IP 整合在晶片中，並將標準的周邊界面列為基本規格，則系統將可因不同的需求來搭配不同的周邊，可有效節省系統開發成本、增加設計效率以及加快產品上市時程，提昇產品競爭力。另外，公司也投注大量的資源在封裝上的評估，就是要幫忙客戶透過封裝的方式讓產品更具多樣性，並且能夠降低整體的成本，達到 Time-to-Market。

C.對晶圓代工廠依賴度高，高階製程 IP 難尋

因應對策：

與晶圓代工廠維持長期友好的合作關係並進行開發合作或策略聯盟，以確保晶圓來源及產品品質，並確保 IP 的品質及來源。除此之外，對人員的養成及培訓也是重點。

D.工控/嵌入式/高效能運算應用範圍廣泛

因應對策：

目前已與國內自動化領導廠商提供專用晶片設計開發，以累積數年高階晶片設計導入經驗加上系統整合專業知識，更能聚焦工業自動化以及軍工市場，相信本公司的產品策略能在利基市場能應用更為廣泛，出貨量必能提昇。在高效能運算部分，因其市場應用面不同，不能只著重 CPU 的效能更要結合加速零件、元件以符合客戶的使用需求。因此除持續投資於 x86 核心技術精進外，並開發必要的 IP，如高速傳輸 I/O，動態電路 (Dynamic Circuit)，開放匯流排的異質結合，使其更符合高效能運算應用的多變性。

(二) 主要產品之重要用途及產製過程

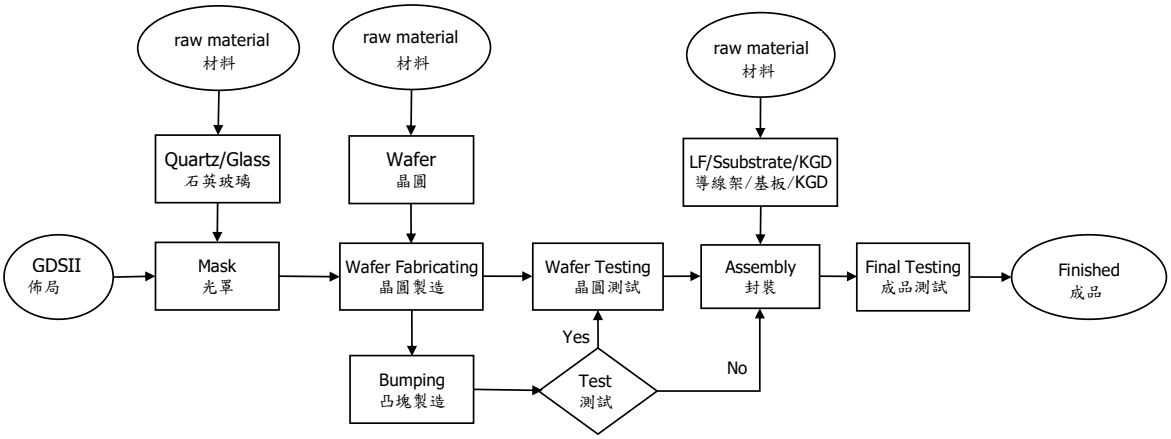
1.主要產品之重要用途

主要產品	應用領域
微控制器半導體元件(晶片)	高效運算(HPC)、工業控制器、平面顯示器(FPD)、量測儀器、工業網通、節能控制、馬達控制、工業電腦板卡、可編程自動化控制器、人機介面、工業用無風扇強固式電腦(Fanless Box PC)、數位控制器、嵌入式類應用

2.主要產品之產製過程

(1)產品製造程序流程圖

本公司是 IC 設計公司，晶圓之製造係委由晶圓代工廠生產，晶圓廠生產出來的晶片，經過初步測試後，送封裝廠封裝，再送交外包廠商進行完整之晶片功能測試。以下為產品製造程序之流程圖：

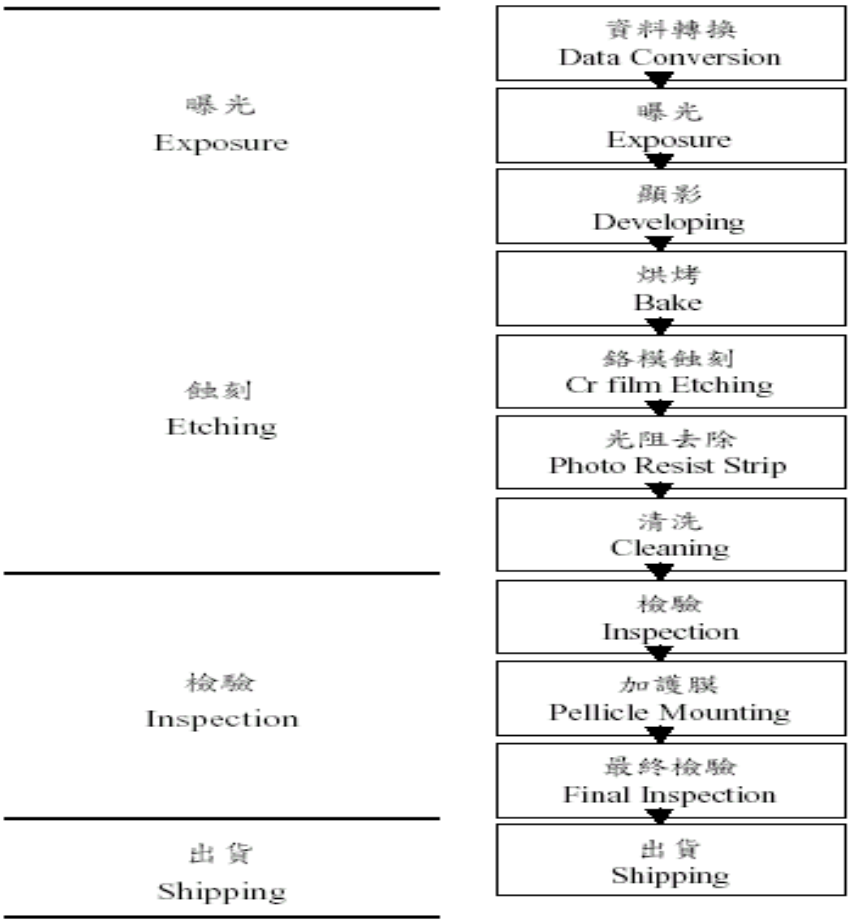


(2)設計流程

IC 產品的源頭來自 IC 設計，藉由 CAD 等輔助工具將客戶或自行開發產品的規格與功能藉由電路設計由 IC 表現出來。

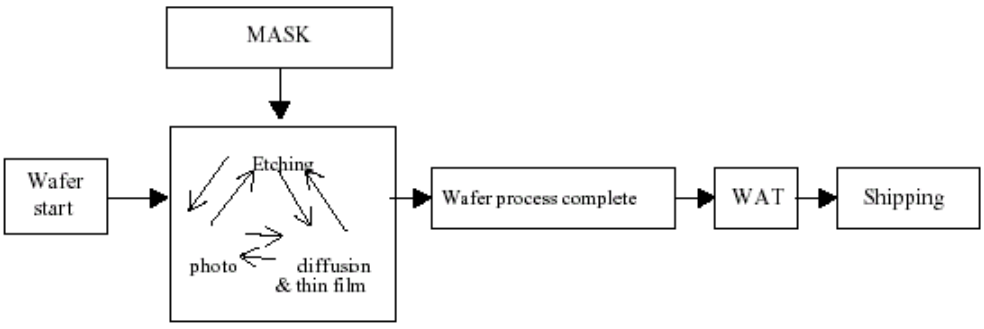
(3)光罩流程

IC 設計完成的線路以佈局資料檔(GDSII)格式呈現, 並交由光罩公司製作，製作的方式分四個階段：曝光、蝕刻、檢驗、及出貨，完成之光罩交由製作晶圓 FAB。



(4)晶圓製作流程

晶圓製作是很複雜的製程，但製作過程仍於 FAB 內完成。由晶圓下線後進入 module 內經由 etching、photo、implant 與 diffusion 各 process area 配合光罩的使用，使晶圓製造完成，完成的晶圓再經電性測試，合格則可出貨，不合格則不出貨。

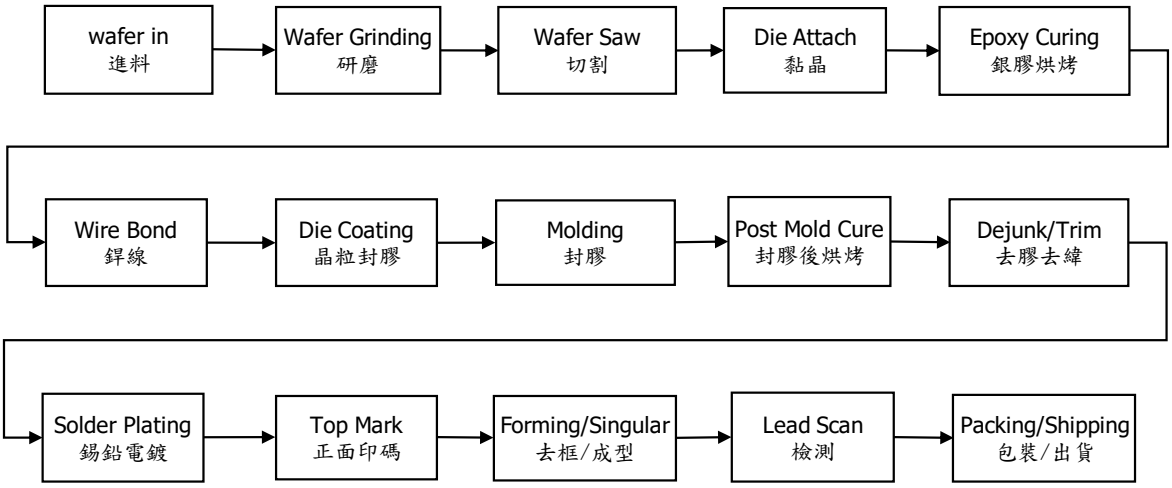


(5)測試流程

製程完成之晶圓則委託外部之測試廠作測試，區分 good dice 與 fail dice。

(6)構裝流程

需作構裝品之產品依實際需求由 good dice 完成構裝品包裝，包裝的流程如下：



(三) 主要原料之供應狀況

本公司主要原料為矽晶圓片(Wafer)，且目前大都是委由國內晶圓代工廠進行原料之採買與代工。由於產業中之專業，國內的晶圓代工廠都屬於是國際級一級大廠，所以無論是在原料的品質、代工的交期、產品的良率等等，都有相當程度的水準，因此，也讓本公司在原料供應上沒有後顧之憂。

原料名稱	主要來源	供應情形
晶圓	聯電、USJC (註)、台積電、聯穎	良好
封裝	矽品、日月光	良好
測試	京元、鴻谷、立衛	良好

註：United Semiconductor Japan Co., Ltd. (簡稱 USJC)，為原三重富士通半導體(Mie Fujitsu Semiconductor Limited 簡稱 MIFS)係富士通半導體(Fujitsu Semiconductor)代工業務之分割事業，已於 2020/1 被 UMC merge。

(四) 最近二年度任一年度中曾占進(銷)貨總額百分之十以上客戶名稱及其進(銷)貨金額比例，並說明其增減變動原因：

1.最近二年度任一年度中曾占進貨總額百分之十以上供應商資料

單位：新台幣仟元；%

項目	112 年度				113 年度				114 年度截至前一季止			
	名稱	金額	占全年度進貨淨額比率	與發行人之關係	名稱	金額	占全年度進貨淨額比率	與發行人之關係	名稱	金額	占全年度進貨淨額比率	與發行人之關係
1	C	17,082	44%	無	C	42,865	58%	無	E	5,963	38%	無
2	D	10,880	28%	無	D	20,915	29%	無	D	5,461	35%	無
3	B	7,722	20%	無	B	7,584	10%	無	C	2,355	15%	無
4	—	—	—	—	—	—	—	—	B	1,789	11%	無
5	其他	3,167	8%	無	其他	1,927	3%	無	其他	—	—	無
	進貨淨額	38,851	100%		進貨淨額	73,291	100%		進貨淨額	15,568	100%	

增減變動原因：本公司與主要供應商均保持良好及長久的合作關係，進貨來源穩定，113 年度較 112 年度進貨淨額增加，主係銷貨成長所致。

2.最近二年度任一年度中曾占銷貨總額百分之十以上客戶資料

單位：新台幣仟元；%

項目	112 年度				113 年度				114 年度截至前一季止			
	名稱	金額	占全年度銷貨淨額比率	與發行人之關係	名稱	金額	占全年度銷貨淨額比率	與發行人之關係	名稱	金額	占全年度銷貨淨額比率	與發行人之關係
1	甲	104,165	35%	無	戊	118,196	28%	無	戊	32,587	43%	無
2	戊	83,449	28%	無	甲	85,498	20%	無	甲	16,068	21%	無
3	辛	30,340	10%	無	庚	83,228	20%	無	乙	7,716	10%	無
4	其他	83,823	27%	無	其他	137,773	32%	無	其他	18,841	26%	無
	銷貨淨額	301,777	100%		銷貨淨額	424,695	100%		銷貨淨額	75,212	100%	

增減變動原因：113 年度主係依合約完成度認列之設計收入增加，致整體銷貨淨額增加。

三、最近二年度及截至年報刊印日止從業員工資料：

單位：人

年　　度		112年度	113年度	截至114年4月30日
員工人數	研發人員	47	57	60
	非研發人員	30	30	30
	合 計	77	87	90
平 均 年 歲		40.32	38.84	38.34
平均服務年資		9.96	8.72	8.31
學歷分佈比率	博　　士	1.30	1.15	1.12
	碩　　士	59.75	62.07	65.17
	大　　專	38.95	36.78	33.71
	高　　中	—	—	—
	高中以下	—	—	—

四、環保支出資訊

最近年度及截至年報刊印日止，因污染環境所受損失(包括賠償)及處分之總額，並說明未來因應對策(包括改善措施)及可能之支出(包括未採取因應對策可能發生損失、處分及賠償之估計金額，如無法合理估計者，應說明其無法合理估計之事實)：

本公司為位於科學園區內之 IC 設計業，所營業務主要為 16 位元及 32 位元微控制器、微機電整合應用產品、32 位元及 64 位元微處理器、IA 自動化系統單晶片(SoC)產品、數位系統應用產品及伺服器暨雲端儲存系統晶片產品之研究、開發、製造及銷售，係以委外加工之方式進行生產，所以本公司並無廢水、廢氣和噪音之產生，不會產生公害污染問題，因此最近年度及截至年報刊印日止並無因污染環境遭受損失及處分。

為因應歐盟有害物質限用指令(RoHS)的需求，本公司的產品均可符合歐盟有害物質限用指令(RoHS)的規範要求，以滿足國際社會對於綠色環境的需求。

五、勞資關係

(一) 公司各項員工福利措施、進修、訓練、退休制度與其實施情形，以及勞資間之協議與各項員工權益維護措施情形：

員工是企業最重要的資產，擁有適當且足夠之人才，公司方能持續發展與進步。本公司重視員工待遇及福利，並落實勞工法令，保障員工權益，創造明朗愉快的工作環境，並加強與員工宣導，來防止勞資糾紛發生。透過勞資會議、部門會議、年度會議、意見箱及專責申訴等管道，達到充分溝通及有效解決問題之目的。

除有效維持和諧勞資關係外，亦以尊重與推行國際人權為宗旨，遵循性別工作平等法、工作場所性騷擾防治措施申訴及懲戒辦法，提供員工優質就業環境。針對有關勞資關係之各項經營與推行，包含各項員工福利措施、進修、訓練、退休制度等，皆以優於或符合法令之前提下進行規劃與落實執行。亦每年定期舉辦員工健康檢查，關心員工健康，促進勞資關係和諧。

本公司於民國 113 年度及截至年報刊印日止，並無任何因勞資糾紛所遭受之損失，且於上述完整制度之訂定及公司持續努力經營下，將可有效避免勞資糾紛或遭受損失。

1.員工福利措施：本公司為每位同仁提供全方位的保險制度，享有勞、健保，另補助部份提供午晚餐點及汽機車停車位供同仁申請，每年優於勞基法之特定彈性假，並設有職工福利委員會，以推行各項福利活動：如慶生、社團活動及年度國內、國外旅遊等；並有員工分紅、婚喪喜慶禮金、急難救助慰問、三節贈禮等福利措施，近來更有員工持股信託。另外在員工健康上，除了法規定期檢查外，優於法規補助全體員工進階檢查（包含抽血、超音波及預防性篩檢項目），使員工能無後顧之憂的安心工作，以最佳的工作回應給公司及社會。

2.進修：本公司訂有在職進修學位辦法，符合資格員工可獲得公司學分費補助。

3.訓練：本公司訂有教育訓練辦法，教育訓練範圍廣闊，包含三大類：訓練課程、購書自修、延聘講師等尤其對於績效良好者提供專門之培訓機會，做為公司對同仁工作績效之獎勵與肯定。教育訓練課程，包括新進人員培訓、專業技術培訓、管理才能培訓及在職進修等學習資源，提供所有員工一個能持續學習成長的工作環境。

4.退休制度與其實施狀況：本公司對正式員工訂有退休金辦法，並依勞基法有關規定於 90 年 9 月 25 日經北市勞二字第 9023705600 號函核准，組成「勞工退休準備金監督委員會」，按月按員工薪資額 2%提撥退休準備金，專戶儲存於臺灣銀行信託部。另自民國 94 年 7 月 1 日起，本公司依據「勞工退休金條例」，訂有確定提撥之退休辦法，適用於本國籍之員工。本公司就員工選擇適用「勞工退休金條例」所定之勞工退休金制度部分，每月按不低於薪資之 6%提繳勞工退休金至勞保局員工個人帳戶。有自願提繳退休金者，另依自願提繳率自員工每月薪資中代為扣繳至勞保局之個人退休金專戶。

退休金制度	舊制	新制
適用法源	勞動基準法	勞工退休金條例
提撥方式	按員工每月薪資總額 2%提撥，以本公司名義存入台灣銀行(原中央信託局)之專戶。	依員工投保等級提撥 6%至勞工保險局個人專戶。
提撥金額	勞工退休準備金累積金額新台幣 28,365 仟元(註)	113 年度提撥新台幣 5,092 仟元。

註：截至 113 年 12 月 31 日之累積金額。

5.勞資間之協議與各項員工權益維護措施情形：本公司勞資關係和諧，未曾發生勞資糾紛，加以本公司一向重視員工意見，可透過電子郵件溝通意見並定期召開勞資會議進行相關議題討論，以維持良好勞資關係。

(二) 最近年度及截至年報刊印日止，因勞資糾紛所遭受之損失，並揭露目前及未來可能發生之估計金額與因應措施：無。

六、資通安全管理

(一) 敘明資通安全風險管理架構、資通安全政策、具體管理方案及投入資通安全管理之資源等。

1.資通安全風險管理架構

本公司由資訊安全室負責統籌制訂並定期檢討資安政策，建立資安事件通報與應變機制，持續深化防衛能力及加強同仁資訊安全意識並訂定電腦化資訊系統處理及控制作業，落實內控制度與維護資訊安全，透過每年檢視及評估其安全規章及程序，確保其適當性和有效性。且由稽核室每年就控制作業，進行資訊安全查核，評估公司資訊作業內部控制之風險改善。

2.資通安全政策

為落實資安管理，以期望達成下列政策目標：

(1).參考國際資安標準並遵守國內外資訊安全法規，定期修訂資訊安全規範。

(2).強化資安專業能力並與外部資安專家團隊合作，早期發現並防止資安威脅。

(3).確保資訊資產之機密性、完整性。

(4).控制各部門資料存取權限，防止未經授權之資料修改或系統存取。

(5).持續資安教育宣導及災難復原演練。

(6).不定期進行釣魚郵件演練及防範措施。

(7).每季進行資安會議討論及防範措施。

3.具體管理方案及投入資通安全管理之資源

(1).網路攻擊防禦：建置新世代防火牆與入侵偵測系統防止系統被惡意攻擊或入侵。

(2).防毒防駭防勒索：電腦設備佈建完整端點防護軟體並定期修補。

(3).郵件閘道主機：建置電腦病毒與惡意軟體過濾機制。

(4).電腦設備定期更新安全修補檔案：電腦系統自行派送安全修補檔案以防止安全漏洞產生。

(5).OA 系統主機虛擬化：OA 重要系統主機皆虛擬化並定期備份，若有主機故障可迅速移轉復原。

(6).RD 研發資料不落地：公司重要 RD 研發技術皆在 Citrix 環境內開發，可避免資料外洩，或被惡意攻擊的風險並定期備份。

(7).電腦機房不斷電系統：機房內所有設備皆接在不斷電系統上，以確保電源穩定並由廠商保養維護。

(8).資料存取記錄備存：系統與文件皆定期備份並每年不定期執行系統資料復原測試，以確保資訊系統之正常運作及資料保全完整。

(9).資訊部門軟硬體設備的資產需統一管理，並有效的保護資產。

(10).確保資訊帳戶存取權限與系統之變更，均經過公司規定程序授權處理。

(11).監控資訊系統之安全，有效掌握並處理資訊安全異常事件。

(12).已加入 TWCERT/CC 和科學園區資安資訊聯盟以取得最新資安情資。

(13).自 113 年 1 月起每季定期召開資安管理會議，制訂與調整資訊安全政策，審查資訊安全發展現況及未來方向，確保資訊安全管理制度持續運作。

4.投入資通安全管理之資源

資訊安全已為公司營運重要議題，對應資安管理事項及投入之資源方案如下：

(1).專責人力：設有專職之企業組織「資訊安全室」負責公司資訊安全規劃、技術導入與相關的稽核事項，以維護及持續強化資訊安全。

(2).資安公告：本年度發佈 2 份資安中心公告，傳達資安防護相關規定與注意事項。

(3).所有新進員工於新人教育訓練時，進行資安政策及目標之宣導。

(4).不定期跟同仁宣導資安風險及目前最新的資安情資，以強化人員資安意識。

(5).本年度指派資訊安全室同仁參加 4 次外部資通會議及資通安全教育訓練課程，吸收新知更新資安知識。

(6).客戶滿意：無重大資安事件，無違反客戶資料遺失之投訴案件。

(二) 列明最近年度及截至年報刊印日止，因重大資通安全事件所遭受之損失、可能影響及因應措施

最近年度及截至年報刊印日止，本公司並未發現或遭受重大資通安全事件，而對公司營運產生重大不利影響。

七、智慧財產管理計畫

為強化產業領導地位並維護得之不易的先進技術成果，本公司擬定結合公司營運目標與研發資源的智慧財產策略，建立一套藉由智慧財產權來創造公司價值的運作模式，不僅保護公司營運自由，另一方面亦可強化競爭優勢，並可援引用來幫助企業獲利。

(一) 專利管理

本公司的智財管理策略主要為專利版圖佈署戰略，透過評審機制、獎勵制度、宣導教育等執行層面的落實，保護公司研發成果及技術領先地位。

本公司為建構堅實的智慧財產權組合，對內，公司設計多元鼓勵創新機制，持續激勵員工提出發明申請，同時建立系統化的專利智權管理制度，輔以分級審查的評鑑流程，兼顧員工專利申請的數量與品質。對外，則結合外部專利事務所資源，與本地及國外主要市場所在地的專利主管機關進行密切聯繫與技術交流，協助專利審查委員更加瞭解本公司技術內容，以提升審查效率並取得高品質專利保護。

(二) 營業秘密管理

按營業秘密無須官方註冊登記，只需符合營業秘密法第 2 條所規定三要件：「非一般涉及該類資訊之人所知者。」、「經濟性」、「採取合理保護措施」即可受法律保護。

營業秘密攸關公司技術領先、製造卓越、客戶信賴等競爭優勢，不僅是著眼於特定智慧資產的保護。為全面有效地管理營業秘密創新，本公司建立「營業秘密註冊制度」，記錄並整合運用具有公司競爭優勢的營業秘密。

另為落實員工智慧財產意識，本公司於聘僱契約規定如下：

1.員工有保守個人經辦業務及公司業務機密之義務。

2.員工任職或離職後，均不得洩漏任何業務機密。

3.受僱本公司員工，亦不得洩露或使用前雇主所有之營業秘密。

(三) 著作權管理

著作權無須官方註冊登記，只要具備原創性，完成創作即取得著作權。為保護公司開發之技術權利，公司在研發階段，即要求各研發人員定期保留開發階段的程式碼及相關文件，針對重要核心之技術，得視需要辦理著作權公證，以證明獨立創作，避免公司重要技術資料不當公開、複製或非法使用。

(四) 商標權管理

本公司自成立起，即積極於公司服務主要提供市場所在國家進行商標註冊，以取得商標權之保護。公司配置專人負責商標之申請與管理，確保公司註冊商標之使用與權益不受侵害。

(五) 執行情形

本公司已將智慧財產相關事項提報第 10 屆第 8 次（112 年 10 月 25 日）董事會進行報告。

本公司自民國 91 年起導入智權管理制度，截至民國 113 年執行情形如下：

- 91 年制訂「專利申請管理作業程序」。
- 94 年制訂「營業秘密管理辦法」導入智財管理計畫，以提升智財權能量。
- 104 年修訂「專利申請管理作業程序」，增加提案獎勵制度。
- 111 年推行「營業秘密註冊制度」並訂定「營業秘密註冊獎勵辦法」。

截至 113 年 9 月底，取得智慧財產權成果如下：

1. 專利：國內外專利獲准總數為 88 件(發明：87 件，新型：1 件)，國外發明專利申請案 4 件。
2. 營業秘密註冊登記：營業秘密註冊登記 7 件。
3. 商標：國內外商標註冊登錄共 10 件。

八、重要契約

契約性質	當事人	契約起迄日期	主要內容	限制條款
技術授權合約書	聯陽半導體	94/02/25~	IT8211 IDE	不得轉授權
授權合約	智原科技	92/07/20~	0.18 um GII Cell Library	不得轉授權
技術移轉授權合約書	國立清華大學	96/10/02~	整合開發工具組及除錯器技術	不得轉授權
租賃合約	新竹科學工業園區管理局	110/01/01~ 129/12/31	土地租賃	無
三年期採購合約	Synopsys International Limited Taiwan Branch	113/04/12~ 116/04/26	專案使用之無形資產(single use)	不得轉授權

伍、 財務狀況及財務績效之檢討分析與風險事項

一、財務狀況

(一) 財務狀況比較分析表

單位：新台幣仟元

年度 項目	112 年度	113 年度	差異	
			金額	%
流動資產	290,644	305,819	15,175	5.22
不動產、廠房及設備	176,644	218,399	41,755	23.64
其他資產	223,543	253,497	29,954	13.40
資產總額	690,831	777,715	86,884	12.58
流動負債	104,366	120,912	16,546	15.85
長期借款	—	—	—	—
其他非流動負債	7,227	4,865	(2,362)	(32.68)
負債總額	111,593	125,777	14,184	12.71
股本	698,265	703,065	4,800	0.69
資本公積	67	85,309	85,242	127,226.87
保留盈餘	(96,073)	(114,060)	(17,987)	(18.72)
其他權益	(23,021)	(22,376)	(645)	(2.80)
權益總額	579,238	651,938	72,700	12.55

註：與去年同期增減% = (今年-去年）/（去年的絕對值）

(二) 公司最近二年度資產、負債及權益發生重大變動項目之主要原因及影響：

1. 不動產、廠房及設備：因應專案需求增加購置試驗設備。
2. 其他非流動負債：主係依退休金精算報告調減淨確定福利負債所致。
3. 資本公積：係因本年度以私募方式辦理現金增資因而產生普通股溢價。

(三) 未來因應計畫：

本公司將充分比較運用資本市場各項理財工具，取得成本較低廉之營運資金，並妥善安排資金運用。每年都有新產品將陸續開發量產及出貨，將能持續增強公司營運績效，進一步強化財務結構。

二、財務績效

(一) 財務績效比較分析表

單位：新台幣仟元

年度 / 項目	112 年度	113 年度	增(減)金額	變動比例%
營業收入淨額	301,777	424,695	122,918	40.73
營業成本	108,416	114,722	6,306	5.82
營業毛利淨額	193,361	309,973	116,612	60.31
營業費用	309,645	340,811	31,166	10.07
營業(損失)利益	(116,284)	(30,838)	85,446	73.48
營業外收入及支出	3,288	6,592	3,304	100.49
稅前淨(損)利	(112,996)	(24,246)	88,750	78.54
所得稅費用	2,240	132	(2,108)	(94.11)
本期淨(損)利	(115,236)	(24,114)	91,122	79.07
其他綜合(損)益	(3,901)	6,772	10,673	273.60
本期綜合(損)益總額	(119,137)	(17,342)	101,795	85.44

(二) 最近二年度增減比例變動分析說明：

1. 營業收入淨額、營業毛利淨額、營業(損失)利益：主係本期增加依合約完成度認列之設計收入，致使營業收入、毛利淨額與營業利益皆上升。
2. 營業外收入及支出：主係匯率波動，致使營業外收入及支出產生較大差異。
3. 稅前淨(損)利、本期淨(損)利、本期綜合(損)益總額：主係營業收入增加所致。
4. 所得稅費用：係依國際會計準則第 12 號「所得稅」計算產生之所得稅費用變動。
5. 其他綜合(損)益：係依退休金精算報告計算之確定福利計劃之再衡量數變動。

(三) 預計銷售數量及其依據：

本公司係依據已掌握之訂單、同業概況及市場平均成長率，預計未來一年度微控制器半導體元件及系統模組之銷售數量，約為 1,501 仟個，平均單價亦將隨產品應用的不同，較以往增加。

(四) 對公司未來財務業務之可能影響及因應計畫：

展望 114 年的發展，除進行中的開發案將相繼流片外，公司亦積極開發新客戶，於 2024 年度持續於 x64CPU out of order CPU 新架構開發，務求於 2025 年度能 Tape out x64 12nm 晶片，前景可期，自動化及 IPC 客戶業務也將逐步回升，奠定營收基礎；公司將在下面幾個開發目標機會下持續與客戶洽談開發(ASIC)合約，(1).64 位元 4/8 核心&(2).64 位元 16 核心：工業/自動化 IPC 應用/PC，NB、(3).64 位元 32/64 核心：edge server/AI server、(4).64 位元 128 核心：data center、(5).PCIe Switch、(6).5G 基地台、(7).x86 SoC ASIC。公司除已掌握

於先進製程上的設計開發技術，亦可提供客戶使用成熟製程搭配先進封裝的解決方案，有助於客戶的專案評估及縮短開發時程，落實洽談中的專案，創造客戶市場價值及增進公司業務。公司在開發新案時亦持續投注大量資源於研發，希冀能把握住每個成長的契機，為股東創造最大利益。

三、現金流量

(一) 本年度現金流量

單位：新台幣仟元

期初現金餘額 (1)	全年來自營業活動淨現金流量 (2)	全年現金流出量 (3)	現金剩餘（不足）數額 (1)+(2)-(3)	現金不足額之補救措施	
				投資計劃	理財計劃
67,478	94,352	94,131	67,699	—	—

(二) 本年度現金流量變動情形分析：

1.營業活動：全年營業活動淨現金流入 94,352 仟元，主係本期依照合約完成度認列之設計收入較為增加所致。

2.投資活動：全年投資活動淨現金流出 200,865 仟元，係因本期針對專案需求所購置之不動產、廠房及設備與無形資產皆較 112 年度增加。

3.籌資活動：全年籌資活動淨現金流入 106,734 仟元，主係舉借短期借款並以私募方式辦理現金增資所致。

(三) 流動性不足之改善計畫：不適用。

(四) 未來一年現金流動性分析：

單位：新台幣仟元

期初現金餘額	預計全年來自營業活動淨現金流量	預計全年現金流出量	預計現金剩餘（不足）數額	預計現金不足額之補救措施	
				投資計劃	理財計劃
67,699	230,406	170,428	127,677	—	—

四、最近年度重大資本支出對財務業務之影響：無。

五、最近年度轉投資政策、其獲利或虧損之主要原因、改善計畫及未來一年投資計畫：無。

六、風險事項分析及評估

(一) 利率、匯率變動、通貨膨脹情形對公司損益之影響及未來因應措施：

1.最近年度利率變動情形對公司損益之影響及未來因應措施

單位：新台幣仟元

項目\年度	112 年度	113 年度
利息收入(1)	1,575	1,804
利息費用(2)	608	1,708
營業收入(3)	301,777	424,695
營業淨(損)利(4)	(116,284)	(30,838)
(1)/(3)	0.52%	0.42%
(1)/(4)	(1.35%)	(5.85%)
(2)/(3)	0.20%	0.40%
(2)/(4)	(0.52%)	(5.54%)

本公司 112 年度及 113 年度利息費用分別為 608 仟元及 1,708 仟元，占該年度營業收入分別為 0.20%及 0.40%，占該年度營業(損失)分別為(0.52%)及(5.54%)，由此可見利息收入及費用對本公司損益影響甚微。本公司未來將視金融利率變動予以調整資金運用情形，以降低利率變化對公司損益產生之影響。

2.最近年度匯率變動情形對公司損益之影響及未來因應措施

單位：新台幣仟元

項目\年度	112 年度	113 年度
兌換利益(1)	1,491	5,990
營業收入(2)	301,777	424,695
營業淨(損)利(3)	(116,284)	(30,838)
(1)/(2)	0.49%	1.41%
(1)/(3)	(1.28%)	(19.42%)

本公司 112 年度及 113 年度兌換利益分別為 1,491 仟元及 5,990 仟元，佔該年度營業收入分別為 0.49 %及 1.41%，占該年度營業淨(損)利分別為(1.28%)及(19.42%)，本公司之銷貨主要以美金計價，故匯率變動對本公司損益具有一定之影響，故為因應匯率變動對本公司損益所產生之風險，財務人員隨時掌握匯率變動的走勢，做為遠匯買賣及結匯之參考依據，營業單位向客戶報價前，應先行對未來之匯率走勢及影響因素做綜合的考量與評估，以決定適當且合理之報價，規避匯率變動之風險，降低匯率變動對合併公司損益之影響。

3.通貨膨脹情形對本公司損益之影響及未來因應措施

本公司對客戶之報價，係參考市場原物料價格之波動機動調整，不致產生重大影響，故通貨膨脹對本公司之損益不致有明顯之影響，本公司將視未

來通貨膨脹情形調整產品售價及降低生產成本以因應市價變化。

(二) 從事高風險、高損捍投資、資金貸與他人、背書保證及衍生性商品交易之政策、獲利或虧損之主要原因及未來因應措施

本公司並未從事高風險高槓桿的財務投資。本公司業經董事會通過，訂定內部管理辦法，包含「取得或處分資產處理程序」、「資金貸與他人或背書保證作業程序」，惟本公司並無資金貸與他人或背書保證及從事衍生性商品交易之情事。

(三) 未來研發計畫及預計投入之研發費用

114 年度預計投入的研發計劃：

1.22nm 4 核 x86 SoC 的開發量產，預估開發費用新台幣 60,000 仟元。

2.FinFET 多核 Out of order x86 Chiplet SoC 架構開發，預估開發費用新台幣 80,000 仟元。

3. FinFET 先進製程 PCIe Switch Fabric 的設計開發，預估開發費用新台幣 80,000 仟元。

4.高精度 encoder 的設計開發，預估開發費用新台幣 30,000 仟元。

(四) 國內外重要政策及法律變動對公司財務業務之影響及因應措施

本公司營運除依循國內外相關法令規範以外，並隨時注意國內外政策發展趨勢及法規變動情況，並諮詢相關專業人士，以即時作好因應措施，綜觀最近幾年本公司並未受到國內外重要政策及法律變動而有影響財務及業務之情事，故預期未來應不致受國內外重要政策及法令變動而有重大不利之影響。

(五) 科技改變(包括資通安全風險)及產業變化對公司財務業務之影響及因應措施

面對晶片製程技術的改變，從 0.5 微米、0.35 微米、0.18 微米、0.13 微米、進展到 90 奈米、65 奈米、40 奈米、28 奈米、12 奈米等更新製程的時代，除了 EDA 投資成本昂貴，光罩費用更動輒千萬或億元的情形，IC 設計產業已開始由技術密集產業轉向資本密集產業。因此本公司除著重於工業自動化利基型產品及 HPC 高效能運算產品外，並隨時注意下游應用產業之產品發展演變，開發或採用符合未來發展趨勢的技術或製程。

本公司建立完善的網路及電腦安全防護系統以控管及保護公司重要系統能正常運作的功能。但無法百分百保證能完全避免來自第三方攻擊公司的重要系統。因此本公司每年檢視並評估現有網路設備，並在重大事件發生之前，成立相關專案小組，與系統廠商一併討論，以減少網路事件的發生。

故最近年度及截至年報刊印日止，科技改變及產業變化對公司財務及業務並無重大之影響。

(六) 企業形象改變對企業危機管理之影響及因應措施

本公司多年來致力於低功耗、高效能的產品開發，未來在全世界節能相關產業扮演關健零組件供應者的角色，將能維持綠能企業形象，並會隨時遵守法令規定。若有影響企業形象或違反法令之情形，將組成專案小組，擬定對策因應。故最近年度及截至刊印日止，未發生足以影響企業形象之情事。

(七) 進行併購之預期效益、可能風險及因應措施：無。

(八) 擴充廠房之預期效益、可能風險及因應措施：無。

(九) 進貨或銷貨集中所面臨之風險及因應措施：

本公司係屬 Fabless IDH (Fabless IC Design House；無自有晶圓廠之專業 IC 設計公司)，產品之主要原料為晶圓代工所產製之晶圓(wafer)，本公司晶圓之主要採購對象為台積電、聯電、聯穎光電及 United Semiconductor Japan Co., Ltd. (簡稱 USJC)。Fabless IDH 沒有晶圓廠、必須仰賴 Foundry 業者提供適合的製程與足夠的產能來擴充其業務；Foundry 業者由於沒有自有產品，所建置之生產線全賴代工的訂單來填滿，雙方唯有達成緊密的夥伴關係，才能共創雙贏局面。因此 IC 設計業者在國內製程能力、技術及交期配合等地緣便利性考量下，仰賴國內晶圓廠代工之比例均相當高；基於供貨來源及長期策略合作關係，國內 IC 設計公司大多有集中於特定晶圓代工廠之行業特性。

本公司所面臨之進貨集中的風險，如下列：

1.產能滿載而無法充裕供應之風險

半導體產業有大幅波動的景氣循環特性，晶圓代工業景氣不佳時，其產能可充分因應 IC 設計業所需而有剩餘，然於景氣暢旺時，各家晶圓代工廠之產能均普遍有供不應求之情形，IC 設計業面臨無法爭取到足夠產能的問題，進而影響營收及獲利。

2.發生天然災害等不可抗力因素之風險

天然災害如火災、風災、水災等無法預料之災害，晶圓代工廠商亦可能面臨發生天然災害之風險，如 921 大地震即造成新竹科學工業園區晶圓代工廠停電停工，對於進貨集中於單一晶圓廠之專業 IC 設計公司而言，上述災害不僅將造成產製時間的延遲及無法及時交貨予銷貨客戶，臨時將代工訂單轉往其他廠商亦可能有困難並增加產製成本之負擔。

本公司採取的因應措施：

台積電、聯電與 USJC 為全球晶圓代工前幾大業者，依過去之交易記錄顯示本公司與台積電、聯電與 USJC 均維持穩定且密切之合作關係，雙方在產能提供、製程提昇、良率改善及預定交期之配合均已建立良好之互動模式，本公司可隨時與台積電、聯電及 USJC 議定討論生產所需之晶圓產能，依交易記錄顯示雙方供貨配合相當穩定，並未曾有供貨短缺或中斷之情事。

銷貨集中風險控管方面，本公司 86 年 8 月設立以來，營運以產品研發為主，致力於及時推出具競爭力產品，因而本公司大部份資源投入與工程相關之研究。為能迅速掌握市場資訊並提高服務效率，除透過專業的代理經銷商將產品銷售給系統製造商，本公司近年來也陸續直接與客戶開發專屬 ASIC 以強化客戶群產品競爭力，拓展市場佔有率。基於上述分析，因本公司目前客戶群已逐年增加，改善單一客戶及代理商每年佔本公司之營收比例相對較大之風險。

本公司對於銷貨集中的因應措施：

1.與既有客戶維持策略性夥伴關係

與既有客戶維持策略性夥伴關係，建立長期合作之競爭優勢，積極開拓市場提高市場佔有率，同時直接對客戶進行技術支援及產品客製化之服務，並與最終客戶保持密切聯繫與互動，使客戶對公司滿意度及信賴度逐年提高，進而降低對代理經銷商銷售依賴度。

2.開發新產品，擴大營運規模

本公司堅強的研發團隊持續開發新產品，提供客戶高品質低成本之產品，提升產品設計及開發能力，並充分掌握市場資訊及未來產品趨勢，期以深具市場競爭力之產品建立自有品牌、擴充營運規模。本公司擁有優良 x86 CPU Core 技術及成本優勢，搭配自行開發之應用軟、硬體，故能在客戶要求之期限內提供品質優良且具價格競爭力的產品，研發技術及製程改良能力深受客戶肯定，未來本公司仍將積極提升研發能力，以延續研發設計之領先優勢。由於本公司擁有大部份自主研發技術，掌握產品品質及成本控制能力絕佳，不僅利於提供物美價廉之產品，將來更可擴大產品線之廣度，以利爭取新客戶。

3.擴展整合方案商經銷商及直接客戶銷售

因應工業級應用、無線網路、多媒體及未來客戶在數位家庭之發展需求，為加速產品上市時效，本公司將持續增加與產品整合方案商(SI)之合作，善用其所長、增加產品附加價值並擴大客戶層面，藉由開發更多新客戶，以分散營運風險及降低銷貨集中之風險。

(十) 董事、監察人或持股超過百分之十之大股東，股權之大量移轉或更換對公司之影響、風險及因應措施：無。

(十一) 經營權之改變對公司之影響、風險及因應措施：本公司最近年度經營權未有重大改變，故不適用。

(十二) 訴訟或非訟事件，應列明公司及公司董事、監察人、總經理、實質負責人、持股比例超過百分之十之大股東及從屬公司已判決確定或尚在繫屬中之重大訴訟、非訟或行政爭訟事件，其結果可能對股東權益或證券價格有重大影響者，應揭露其系爭事實、標的金額、訴訟開始日期、主要涉訟當事人及截至年報刊印日止之處理情形：無。

(十三) 其他重要風險及因應措施：無。

七、其他重要事項：無

陸、 特別記載事項

一、關係企業相關資料：無。

二、最近年度及截至年報刊印日止，私募有價證券辦理情形：請參閱公開資訊觀測站>主題專區>投資專區>私募專區(https://mops.twse.com.tw/mops/#/web/t116sb01)。

三、其他必要補充說明事項：本公司為擴大營運並提供客戶即時支援，於民國 109 年 7 月 29 日經董事會決議通過於新加坡設立 100%持有之子公司-RDC Semiconductor Singapore Pte. Ltd.，該子公司於民國 110 年 3 月 24 日完成註冊，因 COVID-19 疫情反覆，對未來的營運仍在審慎評估及計畫中，惟截至民國 114 年 3 月 31 日止本公司尚未實際注資，故未編制民國 114 年第一季合併報表。截至年報刊印日止，仍尚未注資。

柒、最近年度及截至年報刊印日止，如發生證交法第三十六條第二項第二款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項：無。

金麗科技股份有限公司
113 年股東常會議事錄

中華民國 113 年 6 月 13 日上午 9 時整舉行 113 年度股東常會。

重要決議事項如下：

股東會重要決議	執行情形
1.承認本公司112年度營業報告書及財務報表案。	遵循決議結果辦理。
2.承認本公司112年度虧損撥補議案。	遵循決議結果辦理。
3.核准修正公司章程案。	遵循決議結果辦理。
4.核准以私募方式增資發行新股案。	依據證券交易法第 43 條之 6 規定，公司股東會決議於一年內分次私募有價證券者，應於一年期限屆滿前收足股款或價款。餘尚未募足之額度，於發行期限屆滿，則不再辦理。

董事會重要決議事項：

第十屆第九次 113/03/06	1. 通過 112 年度營業報告書及財務報告。 2. 通過 112 年度虧損撥補議案。 3. 通過 113 年度營運計畫案。 4. 通過 113 年度簽證會計師委任、報酬與其獨立性及適任性評估案。 5. 通過修正公司章程案。 6. 通過修正「董事會議事規範」案。 7. 通過擇定 113 年股東常會開會日期。 8. 通過指定受理股東提案期間及場所。 9. 通過內部控制制度有效性考核及內部控制制度聲明書案。 10. 通過購置供專案使用之無形資產(IP)採購。
第十屆第十次 113/04/30	1. 通過 113 年第一季財務報告案。 2. 通過 112 年度股東常會決議私募有價證券辦理情形。 3. 通過 113 年擬以私募方式增資發行新股案。 4. 通過增列召開 113 年股東常會召集事由案。 5. 通過修正「審計委員會組織規程」案。
第十屆第十二次 113/08/09	1. 通過重編 110 年第一季至 111 年第三季財務報告及更正 109 年度、111 年度、112 年第一季至 113 年第一季財務報告案。 2. 通過重編 110 年度營業報告書及盈餘分派案。 3. 通過 113 年第二季財務報告案。 4. 通過增訂本公司「專案商業顧問聘任管理辦法」。
第十屆第十三次 113/09/25	1. 通過購置供專案使用之無形資產(IP)採購案。
第十屆第十四次 113/10/30	1. 通過民國 113 年第三季財務報告案。 2. 通過修訂本公司內部控制制度及內部稽核實施細則「永續資訊之管理」暨作業辦法「永續資訊管理作業辦法」案。 3. 通過民國 114 年度稽核計畫案。 4. 通過訂定民國 113 年度第一次私募普通股增資基準日、數量及價格案。 5. 通過(薪資報酬委員會提案)檢討績效評估與薪資報酬之政策、制度、標準與結構案。 6. 通過(薪資報酬委員會提案)審核董事次年度薪酬計畫案。 7. 通過(薪資報酬委員會提案)審核經理人績效評估及年度調薪計畫案。

第十屆第十五次 114/03/05	1. 通過民國 113 年度營業報告書及財務報告。 2. 通過民國 113 年度虧損撥補議案。 3. 通過民國 114 年度營運計畫案。 4. 通過民國 114 年度簽證會計師委任、報酬與其獨立性及適任性評估案。 5. 通過修正公司章程案。 6. 通過擇定民國 114 年股東常會開會日期。 7. 通過董事任期屆滿改選及受理董事候選人提名案。 8. 通過指定受理股東提案期間及場所案。 9. 通過內部控制制度有效性考核及內部控制制度聲明書案。 10. 通過內部稽核主管任命案。
第十屆第十六次 114/04/30	1. 通過 114 年第一季財務報告案。 2. 通過 113 年度股東常會決議私募有價證券辦理情形。 3. 通過 114 年擬以私募方式增資發行新股案。 4. 通過董事會提名及列入董事候選人名單暨審查獨立董事案。 5. 通過解除董事競業限制案。 6. 通過增列召開 114 年股東常會召集事由案。

金麗科技股份有限公司

董事長：易建男